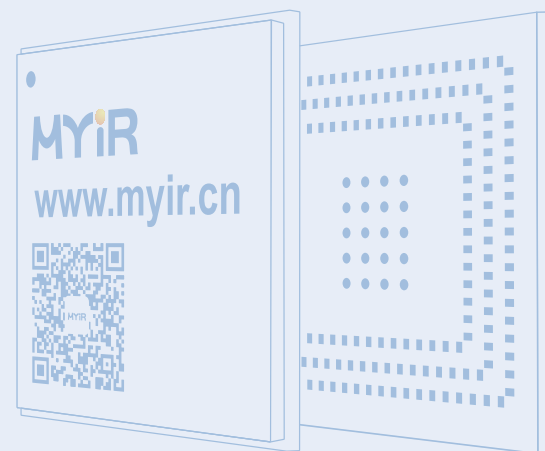
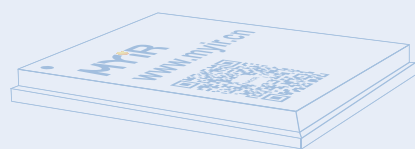


产品手册



领先的嵌入式处理器模组厂商

目录

01

米尔介绍

米尔介绍	02 ~ 14
选型表	15 ~ 16
命名规则	17
产品选型工具	18

02

SOM 核心板

ST系列	19 ~ 22
NXP系列	23 ~ 28
TI 系列	29 ~ 34
瑞萨系列	35 ~ 36
AMD系列	37 ~ 41
全志系列	42 ~ 46
芯驰系列	47 ~ 50
瑞芯微系列	51 ~ 53
新唐系列	54
海思系列	55
紫光同创系列	56
安路系列	57

03

方案与应用

工业单板机	58 ~ 68
工控一体机	69 ~ 72

04

定制服务

ODM服务	73
OEM服务	74

关于米尔

深圳市米尔电子有限公司是一家专注于嵌入式处理器模组设计、研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业和专精特新企业。

米尔电子深耕嵌入式领域10多年，致力于为企业级客户提供基于ARM、FPGA、RISC-V和AI等各种架构，稳定可靠的处理器模组，满足客户大批量产品应用部署的需求，同时为客户提供产品定制设计、行业应用解决方案和OEM的一站式服务。

米尔英文简称“MYiR”，是“Make Your Idea Real”第一个大写字母的缩写。我们的理念是“专业服务助力客户成功”，目前米尔已通过专业高效的服务，帮助全球数万家企业的产品成功上市。



15⁺年
行业经验

45⁺%
研发人员占比

7000⁺M²
研发生产基地

60⁺国
产品销往全球

150⁺项
专利及荣誉

30000⁺
企业客户

发展历程

2011-2012

- 成立深圳总部;
- 成立北京分公司;
- 成立上海分公司;
- 成为ARM官方合作伙伴;
- 成为Xilinx官方合作伙伴;

2013-2017

- 成为TI官方合作伙伴;
- 成为NXP官方合作伙伴;
- 成为AVNET官方合作伙伴;
- 成立米尔武汉分公司及研发中心;
- 总部乔迁至深圳坂田云里智能园;

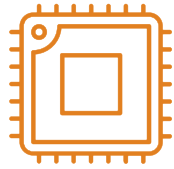
2018-2021

- 深圳观澜SMT智慧工厂落成投产;
- 成为ST官方合作伙伴;
- 成为芯驰官方合作伙伴;
- 成为Mouser官方合作伙伴;
- 成为DigiKey官方合作伙伴;
- 获评国家级高新技术企业;
- 获得ISO9001质量管理体系认证;
- 获得ISO14001环境管理体系认证;

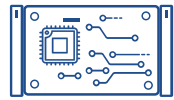
2022-2024

- 成为瑞萨IDH生态合作伙伴;
- 成为全志官方合作伙伴;
- 成为瑞芯微官方合作伙伴;
- 成为新唐官方合作伙伴;
- 获得南瑞认证优质供应商;
- 获得许继认证优质供应商;
- 获得ST授予合作伙伴大奖;
- 获评深圳市专精特新企业;

主营业务



SOM核心板



SBC工控板



Solution解决方案



ODM定制服务



OEM代工服务

覆盖领域



充电桩



储能



电力



PLC



工业自动化



工业网关



商业显示



医疗器械



工程机械



轨道交通



工业 HMI



AI 边缘计算

企业文化



企业使命

构建数字化、智能化、网络化嵌入式产品基石，
为智能制造和智慧生活赋能



企业愿景

成为全球行业客户最信赖的嵌入式处理器
模组供应商



企业价值观

共创、共赢、共享,为客户创造最大价值

信息化管理平台

米尔建立了一系列专业成熟的企业级的信息化管理平台，从物料供应链、产品研发、客户管理、项目管理、员工管理、生产管理等各维度实现全面数字化管理，让业务数据化，让管理可视化，让生产智能化。



企业管理

EPR 系统



客户管理

CRM 管理系统



供应商管理

SRM 管理系统



产品管理

PLM 系统、DFX 系统



生产管理

MES 系统、WMS 仓储管理系统
WMS 智能仓储系统

经营理念



领先技术

不断进行技术创新，为客户提供行业领先的技术和产品。



专业服务

系统化构建客户服务体系，提供售前、
售中、售后一体化技术支持。



交付承诺

提供不低于10年的产品生命周期保障。



品质保障

ISO管理体系，贯穿物料选型、研发设计、
产品测试、生产加工和出货等环节。

企业资质和荣誉



国家高新技术企业



深圳市专精特新中小企业



ISO9001



ISO14001



瑞萨IDH生态合作伙伴



ST授予合作伙伴大奖



许继认证优质供应商



南瑞认证优质供应商



83项

CE、ROHS认证



46项

软件著作权



25项

实用新型专利



18项

发明专利



16项

电路设计



29项

行业媒体奖项

战略合作伙伴



部分企业客户



研发能力

米尔在深圳和武汉都设立了研发中心，拥有资深的技术研发团队，其中研发人员占比45%左右，100%以上拥有本科以上学历，研发团队核心骨干和主要成员均长期深耕嵌入式行业，具备10多年嵌入式行业工作经验，有先进的设计理念和针对大批量产品应用的设计实践。产品具备行业领先的创新性、可靠性和稳定性，累计申请专利、著作权及各种认证100多项。



完善、科学、系统的研发管理体系



研发管理齐备

采用IPD流程管理理念，结合现代化的信息系统管理工具



项目管理



任务管理



缺陷管理



评审管理



设计文件



代码管理



知识经验管理



设计能力优化

建立完善且统一的关键设计节点管控



测试用例



原理图/PCB CheckList



标准电路库



DFX管理



高速信号设计与仿真



物料AVL优选库

技术与技能

硬件开发

- 标准的器件库
- 标准的电路图
- 完整的原理图 (PCB Checklist)
- FMEA分析
- SI仿真设计

软件开发

- 多种操作系统开发能力
Linux | android | RTOS | OpenMemory | OpenEuler
- 内核移植及驱动开发能力
- 系统优化能力
开机时间、实时性、多系统备份、OTA、安全性等优化
- 符合工业及电力场景系统定制能力
- 协议开发和应用开发能力

测试能力

米尔研发测试团队秉承科学严谨、客观公正的态度，依托完善的测试体系和专业丰富的测试经验，对所有产品均依据相关国标、行业标准、公司标准，严格实施全方位测试，确保所有产品具备长期稳定性、可靠性、可批量生产性和数据可溯性。

涉及标准范围

- I2C-bus specification and user manual V.6.pdf
- I2S specification Revision June 5 1996.pdf
- Part E1 SDIO Simplified Specification Version 2.00
- 对应芯片数据手册

主要评测项目

电源测试

- ✓ 对地阻抗测试
- ✓ 纹波测试
- ✓ 上下电波形测试
- ✓ 上下电时序测试
- ✓ 功耗测试
- ✓ Power Noise测试

信号测试

- ✓ I2C测试
- ✓ I2S测试
- ✓ SDIO测试
- ✓ 时钟测试
- ✓ 网口信号测试
- ✓ UART测试
- ✓ CAN测试
- ✓ RS232/RS485

信号测试

涉及标准范围

- EN55032
- IEC61000-4
- NB/T33008.1
- GB/T 17626

主要评测项目

EMI: 电磁干扰

- ✓ RE: 辐射发射
- ✓ CE: 传导发射
- ✓ Harmonics: 谐波电流
- ✓ Flicker: 闪烁

EMS: 电磁敏感

- ✓ RS: 辐射抗扰度
- ✓ CS: 传导抗扰度
- ✓ ESD: 静电抗扰度
- ✓ Surge: 浪涌抗扰度
- ✓ EFT/B: 电快速瞬变脉冲群
- ✓ PMS: 工频磁场抗干扰度
- ✓ Dips: 电压跌落/短时中断

EMC测试

涉及标准范围

- EN 55032:2015
- EN 55035:2017
- IEC62321
- EN 61000-3-3:2013
- EN IEC 61000-3-2:2019

主要评测项目

- ✓ CE认证
- ✓ ROHS认证
- ✓ 国产化认证

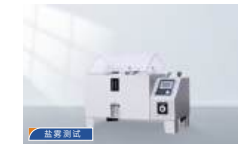
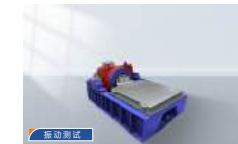


认证测试

涉及标准范围

- GB/T 2423.1-2008
- GB/T 2423.2-2008
- GB/T 2423.22-2012
- GB/T 2423.8-1995
- GB/T 2423.10-2019
- GB/T 2423.5-2019
- GB/T 2423.17-2008
- GB/T 19056-2012

主要评测项目









可靠性测试











技术服务

米尔以客户需求为导向，客户在项目选型、项目立项、项目开发、产品测试、小批量试产、大批量生产等过程中遇到的各种问题，米尔都提供全方位的技术支持和服务。公司一线工程师团队通过在线、电话、邮箱、远程视频会议、现场服务等多种方式协助客户解决技术问题，并提供丰富的学习资料，致力于加速客户开发进程，降低客户开发成本，确保客户产品质量，提升客户产品市场竞争力。






售前服务

 <p>沟通与需求分析 技术服务团队全方位参与分析了解客户需求</p>	 <p>顾问式的选型指导 专业团队推荐性能、功能及成本最佳核心板</p>	 <p>原型验证 确保选定平台的系统设计的可行性和稳定性</p>
 <p>产品选型工具 提供在线系统，快速便捷精准的产品选型</p>	 <p>软硬件框架搭建 确保整体软硬件系统设计符合客户的需求</p>	 <p>项目技术风险评估 识别潜在风险并提出解决方案和应对措施</p>

售中服务

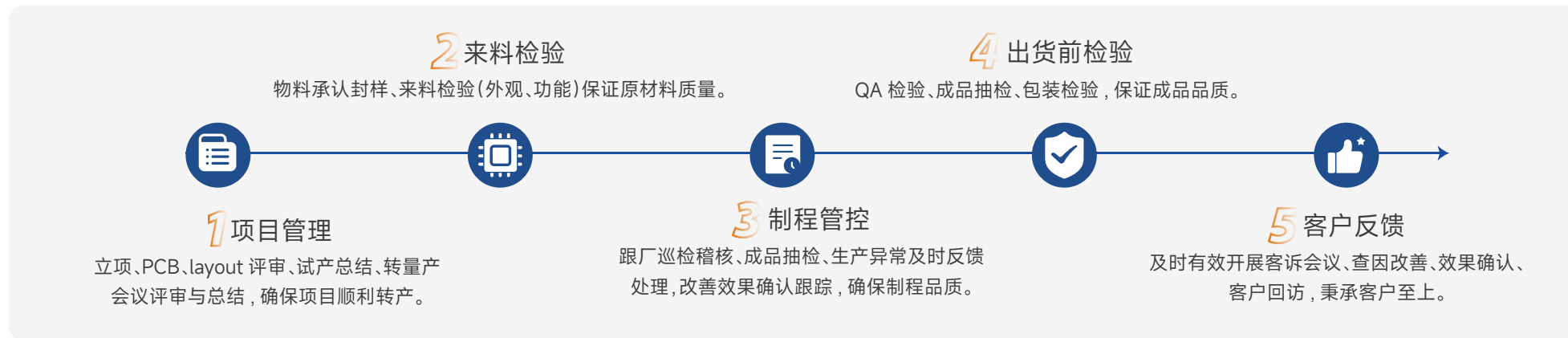
 <p>开发者中心系统 快捷下载丰富的产品资料和技术文档，售后可视化服务等</p>	 <p>原理图及PCB设计指导 确保电路设计布局合理，满足系统性能和稳定性要求</p>	 <p>测试方案指导 确保项目在上线前达到质量标准，保障产品稳定性</p>
 <p>原理图及PCB评审 避免潜在的电路板设计问题和缺陷</p>	 <p>协助样机底层驱动调试 确保硬件和软件之间的兼容性，验证底层驱动的功能和性能</p>	 <p>生产工艺指导 提供生产工艺指导文件作为参考，确保产品效率和品质</p>
 <p>协助中间件移植 确保系统的正常运行和功能完整性</p>	 <p>协助系统优化裁剪 提高系统性能和稳定性，同时减少资源占用</p>	 <p>研发打样服务 提供一站式打样服务和报告，分析可能存在的问题和改进建议</p>
 <p>物料选型指导 从质量、性能和价格等方面提供建议，提高产品竞争力</p>		

售后服务

 <p>远程或现场服务 提供保姆式服务，及时响应客户需求，包括抵达客户现场解决问题</p>	 <p>问题记录与整理 每个客户问题单独备案，以便跟踪问题的根本原因和持续改进措施</p>
 <p>培训与知识分享 帮助客户更好地理解产品使用和维护，提高其技术和产品应用水平</p>	 <p>输出8D报告 内容包含问题描述、根本原因分析、纠正措施、预防措施、改进建议等</p>
 <p>返修换货服务 提供产品快速返修和换货服务，米尔的生产体系可以实现产品级和物料级的批次追溯，方便定位问题，分析问题，解决问题，并提供分析报告和使用建议</p>	

质量保障

米尔从物料来料检验、上线前烘烤、锡膏印刷检测、在线AOI、首件检测、X-RAY抽检、IPQC巡检、QA出货全检层层检验关卡，全方位防静电实时监测，坚持运行ISO9001质量管理体系，保证产品出厂合格率。



系统化的仓储管理

仓库采用X-ray自动点料机和AI智能感应料架，对元器件仓库采用恒温恒湿、防静电、先进先出的管控机制，支持多工单发料，能够实时盘点，物料防丢防错，对接MES和ERP系统，使用及管理全过程可追溯。

WMS智能仓储系统
智能货架搭配智能仓储系统，实现物料零出错



恒温、恒湿、安全
集成电路和电子元器件采用恒温恒湿仓库及存储柜，确保物料的有效及可靠性。



完整的供应链体系

拥有10年以上行业经验的资深供应链管理团队，提供全BOM物料供应、器件选型和替代料推荐，配备专业的BOM工程师和严格、规范的IQC来料检验标准，以及源自原厂和一级代理商的原装正品保证，确保为客户提供交期短、品质好、价格低的元器件保障。



1000+原厂及以及代理商合作（部分合作供应商）



生产能力

米尔拥有5000平米的SMT智慧工厂，打造10万级洁净无尘车间，配备多条SMT生产线，以先进的生产设备和管理系统、严格的品质管控流程、完善的供应链体系、强力的工程支撑等优势，从来料到制程再到出货，层层把关，确保产品质量。工厂贴片能力达到日产能500余万点。所有生产流程符合RoHS和REACH标准。

完善的自动化生产设备

配备松下进口高速双轨贴片线，拥有全自动锡膏印刷机、氮气回流炉、波峰焊、AOI、SPI、X-RAY、智能首件检测仪、智能锡膏管理柜、全自动分板机、三防漆自动涂覆、镭雕机、BGA返修台等设备，并配套MES智能管理系统、智能仓储系统、ERP系统和静电管理系统。



全自动锡膏印刷机



全自动锡膏检测仪 (3D SPI)



NPM-D3A贴片机



NPM-TT2贴片机



在线AOI



三防漆自动涂覆线

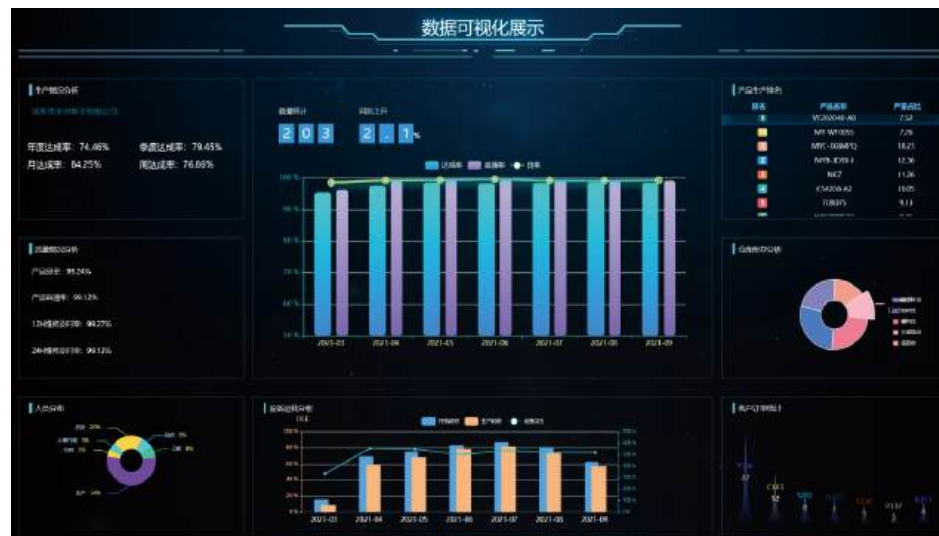
优异的生产环境条件

生产车间设备及流水线工位均安装有LoRa静电监测结点，静电超标可声光报警，并通过网关采集实时传送到数据后台，车间整体静电数据可在大屏上多维度动态展示。



一体化制造信息化管理系统

业界领先的一体化制造信息化管理系统(MES)，实现与ERP、WMS、SRM等系统对接，提高了工厂管理的实时性和透明度，以及产品的全过程追溯和防错管控水平。



选型表

处理器品牌	进口处理器					国产处理器							
产品性能	ST	NXP	AMD	RENESAS	TEXAS INSTRUMENTS	ALLWINNER	芯驰 SemiDrive	Rockchip	HISILICON	nuvoTon	紫光同创	安路科技	
入门级 A7/A8/A9/ A55/FPGA 1-2核	MYC-YF13X ST STM32MP135 A7@1.0GHz 2x千兆以太网, 8xUART, Parallel CSI 2xCAN FD, Parallel LCD	MYC-Y6ULX-V2 NXP i.MX6ULL/i.MX6ULL A7@528MHz 2x千兆以太网, 2xCAN, 8xUART Parallel LCD, Parallel CSI	MYC-J7A100T AMD Atrix 7A100T FPGA: 10K 2x千兆以太网, HDMI, UART Camera, 2xSFP, PCIe2.0	MYC-YG2UL Renesas RZ/G2UL A55@1.0GHz+M33@200MHz 2x千兆以太网, 2xUSB2.0, 1xMIPi CSI 7xUART, 2xCAN FD, 3xSPI, 1xRGB	MYC-CY/JJ335X TI AM335X A8@1.0GHz 2x千兆以太网, 2xCAN, 6xUART 3D GPU, PRU, Parallel LCD	MYC-YT113I Allwinner T113-I 2x@7@1.2GHz 1x千兆以太网, 8xUART, Parallel CSI MIPi DSI, RGB, 2xLVDS, 2xCAN						MYC-J2L100H PANGO Logos2 2L100H FPGA: 99K 2x千兆以太网, HDMI, UART Camera, 2xSFP, PCIe2.0	
	MYC-YA15XC-T ST STM32MP15I A7@650MHz+M4@209MHz 1x千兆以太网, 8xUART Parallel LCD, Parallel CSI		MYC-CY/7Z010/20-V2 AMD XC7Z010/20 ARM: 2x@69766MHz; FPGA: 85K 1x千兆以太网, LCD, USB2.0, CAN UART		MYC-C335X-GW TI AM335X A8@1.0GHz 2x千兆以太网, 2xCAN, 6xUART 3D GPU, PRU, Parallel LCD	MYC-YT113X Allwinner T113-S3 2x@7@1.2GHz 2x千兆以太网, 8xUART, Parallel CSI MIPi DSI, RGB, 2xLVDS, 2xCAN							
	MYC-YA157C-V3 ST STM32MP157 2x@7@650MHz+M4@209MHz 1x千兆以太网, 8xUART, MIPi DSI 2xCAN FD, 3D GPU		MYC-C7Z015 AMD XC7Z015 ARM: 2x@69766MHz; FPGA: 76K 1x千兆以太网, LCD, USB2.0, CAN UART, PCIe2.0, SFP		MYC-C437X-V2 TI AM437X A9@1.0GHz 2x千兆以太网, 2xCAN, 6xUART 3D GPU, PRU, Parallel LCD								
中端性能 A35/A53/A55 2-4核	MYC-LD25X ST STM32MP257 2x@55@1.5GHz+M33@400MHz 3xRGBMI, 4xUSART, MIPi DSI, 8xUART, 3xCAN FD, Parallel RGB	MYC-LMX9X NXP i.MX93 2x@55@1.7GHz+M33@250MHz 2x千兆以太网, 2xCAN FD, 8xUART LVDS, MIPi DSI, MIPi CSI		MYC-YG2LX Renesas RZ/G2L 2x@55@1.2GHz+M33@200MHz 2x千兆以太网, 2xUSB2.0, 7xUART, 2xCAN FD, 3D GPU, VPU, MIPi DSI	MYC-YM62X TI AM62X 1/2/4x@53@1.4GHz+M4@400MHz 2x千兆以太网, 3xCAN FD, 9xUART 3D GPU, PRU, GPMC, LVDS	MYC-LT536 Allwinner T536 4x@55@1.6GHz+R5C@600MHz 2x千兆以太网, 1xUART, 8xDS 2xUSB2.0, LocalBus, 4xCAN FD	MYC-JD9340 SemiDrive D9340 4x@55@1.6GHz+2xR5@800MHz 2x千兆以太网, 2xUSB3.0, 2xPCIe3.0 4xCAN FD, 8xSPI, 12xI2C, 8xPWM	MYC-YR3562 Rockchip RK3562(J) 4x@55@2.0GHz+MCU@200MHz 千兆以太网, 千兆以太网, 10xUART 16xPWM, USB2.0, 2xCAN, SDIO	MYC-LHI5093 HISILICON Hi5093 4x@55@1.0GHz+2xM33@200MHz 2xGE, 2xFE, 3xUSB, 2xPCIe, VCA 2xCAN, 8xUART, 16xI2C, 12xPWM	MYC-LMA35 Nuvoton MA35D1 2x@55@800MHz+M4@800MHz 2x千兆以太网, 4xCAN FD, 17xUART 16bit EBI, 24bit RGB, 2xUSB2.0		MYC-YM90X 芯原科技 SA1LDRACON ARM: 2x@55@800MHz; FPGA: 95K 2x千兆以太网, 2xCAN FD, 2xUSB2.0 2xUART, 2xSD/SDIO, 2xSPI, 2xI2C	
		MYC-C8MIX-V2 NXP i.MX 8M Mini 4x@53@1.8GHz+M4@400MHz 1x千兆以太网, 4xUART, 1xPCIe2.0 MIPi DSI, MIPi CSI, 3D GPU, VPU				MYC-YT507H Allwinner T507H 4x@53@1.5GHz 千兆以太网, 千兆以太网, 6xUART 4xUSB2.0, 2xLVDS, RGB, 3D GPU			MYC-LR3568 Rockchip RK3568(J) 4x@55@1.8GHz 2x千兆以太网, 2xHDMI, 2xMIPi CSI, eSPI, 3, 4xUSB, 2xPCIe3.0, SATA3.0				
高性能 A53/A55/A72 2-8核		MYC-JX8MPQ NXP i.MX 8M Plus 4x@53@1.8GHz+M7@800MHz 2x千兆以太网, 2xCAN FD, PCIe2.0, 2xUSB3.0, NPU, MIPi DSI, HDMI	MYC-CZU3EGHE/BEV-V2 AMD XCZU3EGHE/BEV ARM: 4x@53@1.32GHz+2xR5@533MHz FPGA: 154K(13EG)/192K(4E)/254K(5E) 1x千兆以太网, CAN, LCD, USB3.0 IMX DP, SATA3.0, UART, PCIe2.0		MYC-LT527 Allwinner T527 8x@55@1.0GHz+R5C@800MHz 2x千兆以太网, HDMI, MIPi DSI/CSI 5xUSB, 2xCAN, 10xUART, 4xSPI	MYC-JD9350 SemiDrive D9350 5x@55@1.6GHz+3xR5@800MHz 2x千兆以太网, 2xUSB3.0, 2xPCIe3.0 4xCAN FD, 8xSPI, 12xI2C, 8xPWM		MYC-LR3576 Rockchip RK3576(J) 4x@72@2.3GHz+4xH53@2.2GHz 2x千兆以太网, PCIe, USB3, SATA3, DSMC/FluxBus, 2xCANFD, 12xUART					
		MYC-J1028X NXP LS1028A 2x@72@1.5GHz 4xTEN Switch, 2xGbE, DP1.3xDP1.4 2xUSB3.0, 2xPCIe3.0, SATA 3.0					MYC-JD9360 SemiDrive D9360 6x@55@1.6GHz+R5@800MHz 2x千兆以太网, 2xUSB3.0, 2xPCIe3.0 4xCAN FD, 8xSPI, 12xI2C, 8xPWM						
		MYC-JX8MMA7 NXP i.MX 8M Mini AMD Atrix 7 ARM: 4x@53@1.8GHz+M4@400MHz; FPGA: 23K 千兆以太网, 2xUSB2.0, 4xUART, 3xSPI, MIPi DSI, MIPi CSI					MYC-YD9360 SemiDrive D9360 6x@55@1.6GHz+R5@800MHz 2x千兆以太网, 2xUSB3.0, 2xPCIe3.0 4xCAN FD, 8xSPI, 12xI2C, 8xPWM						

米尔产品命名规则



米尔电子官网产品选型工具

让产品选型更简单、更高效、更精准!

登录入口: www.myir.cn/lists



扫码即可体验

筛选产品分类,
快速定位类别产品



勾选4款处理器模组,
即可对比具体参数

■ 米尔核心板优势



● 创新性设计

- ▶ LCC/LGA封装设计：更稳定可靠的信号连接，更好的抗震动，便于量产批量贴片
- ▶ 屏蔽罩设计：抗信号干扰和防灰尘，同时支持客制化LOGO，提升客户品牌价值
- ▶ 小巧紧凑设计：体积小，设计灵活，适合各种尺寸产品（特别是结构受限产品）

● 卓越的品质

- ▶ 严苛的测试：核心板通过信号、高低温、老化测、静电等6项测试，确保产品稳定性
- ▶ 符合国际认证标准：采用国际SGS作为认证测试伙伴，提供CE和ROHS认证报告
- ▶ 自建智慧工厂：配备一流生产设备，采用MES系统等，保障产品高质量及可追溯性

● 领先的成本

- ▶ 规模效应：核心板每年出货100万片以上，通过规模化生产获得优良的批量物料成本
- ▶ 封装优势：核心板采用LCC/LGA封装设计，可以节省板对板连接器的成本
- ▶ 供应链管理：与各原厂建立深度紧密的合作关系，获得更具竞争力的芯片价格支持

● 快速交付及长生命周期

- ▶ 交期短：完善的标准品库存管理机制，样品订单现货交付，批量订单2~4周交付
- ▶ 生命周期长：10年以上的供货保障，物料停产替代有完善的产品变更流程和通知政策
- ▶ 长期维护：软件长期维护并定期更新BSP包

● 保姆式的技术服务

- ▶ 售前服务：选型阶段最优平台推荐、可行性评估、软硬件框架搭建以及原型功能验证
- ▶ 售中服务：设计阶段原理图、PCB指导与评审，驱动调试、中间件移植和系统优化
- ▶ 售后服务：FAE沟通及时，远程或现场协助解决问题，并记录过程，输出8D报告

● 丰富的开发资源

- ▶ 硬件文档：产品手册、硬件设计指南、硬件用户手册以及核心板引脚使用表
- ▶ 软件文档：快速使用指南、软件开发指南、软件评估指南以及应用笔记
- ▶ 设计资料：底板原理图及PCB源文件，BSP软件源代码以及行业应用DEMO



MYC-YF13X核心板

- 基于STM32MP135新一代通用工业级MPU，具有极高的性价比，内核Cortex-A7@1GHz
- 标准配置支持256M Nand Flash/256M DDR和4GB eMMC/512M DDR两种
- 接口丰富：2路千兆网口、LCD-TFT并行显示接口、Parallel CSI、2个CAN、2个USB、8个UART功能接口
- LCC封装，148PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸37×39mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-YF135-256N256D-100-I	STM32MP135DAF7	Cortex-A7@1.0GHz	256MB DDR3	256MB Nand Flash	32Kbit EEPROM	LCC 148PIN	-40°C~+85°C	37×39mm	Linux	MYD-YF135-256N256D-100-I
MYC-YF135-4E512D-100-I			512MB DDR3	4GB eMMC						MYD-YF135-4E512D-100-I

● 核心板扩展信号

通信接口	2×RGMII、2×CAN FD、2×USB2.0、8×UART、5×SPI、5×I2C
多媒体接口	RGB、DCMI、2×SAI、3×I2S
其他接口	12bit 19ch ADC、12bit 18ch ADC、SWD

● 应用场景



工业HMI



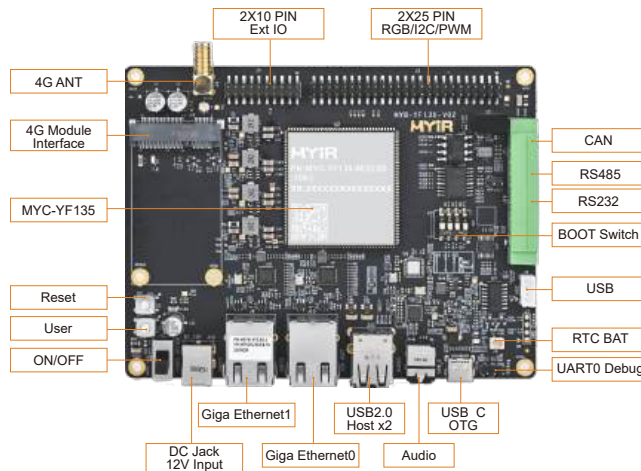
工业网关



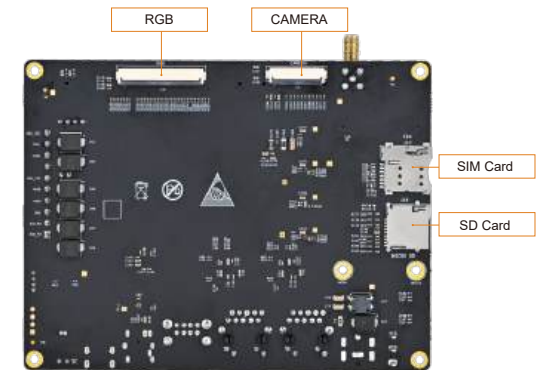
工业控制



能源管理



开发板正面标注图

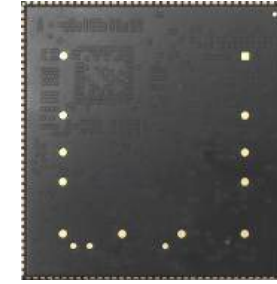


开发板背面标注图



MYC-YA15XC-T核心板

- 基于新一代STM32MP151处理器，高速计算机处理能力，内核Cortex-A7@650MHz+Cortex-M4@209MHz
- 可用STM32MCU生态系统
- 接口丰富：千兆以太网接口、2个USB2.0接口、8路UART、6路SPI、6路I2C
- LCC封装，148PIN；商业级：0°C~+70°C，工业级：-40°C~+85°C；尺寸37×39mm；系统Linux



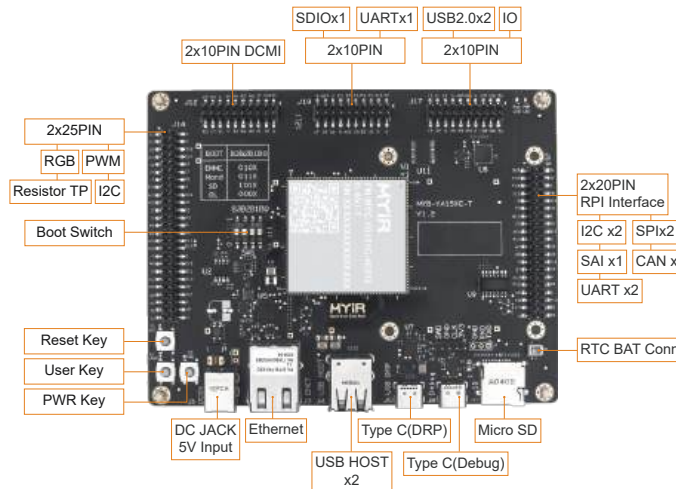
扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-YA151C-256N256D-65-C-T	STM32MP151AAC3	Cortex-A7@650MHz +Cortex-M4@209MHz	256MB DDR3	256MB Nand Flash	32Kbit EEPROM	LCC 148PIN	0°C~+70°C	37×39mm	Linux	MYD-YA151C-V2-256N256D-65-C-T
-40°C~+85°C							MYD-YA151C-V2-256N256D-65-I-T			
0°C~+70°C			MYD-YA151C-V2-4E512D-65-C-T							
-40°C~+85°C			MYD-YA151C-V2-4E512D-65-I-T							

● 核心板扩展信号

通信接口	RGMII、2×USB2.0、8×UART、6×SPI、6×I2C
多媒体接口	RGB、DCMI、4×SAI、3×I2S
其他接口	2×16bit 20ch ADC、SWD



开发板正面标注图



开发板背面标注图

● 应用场景



商业HMI



医疗器械



工业制造



石化



MYC-YA157C-V3核心板

- 基于STM32MP157处理器，支持多种应用场景的HMI2.0应用，内核2×Cortex-A7@650MHz+Cortex-M4@209MHz
- 满足各类场景的资源要求，智能家电，卫生医疗，公共服务等系统场景，支持STM32MCU生态系统
- 接口丰富：千兆以太网接口、2个CAN接口、2个USB2.0接口、8路UART、6路SPI、6路I2C
- LCC封装，164PIN；商业级：0°C~+70°C；工业级：-40°C~+85°C；尺寸43×45mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-YA157C-V3-4E512D-65-C	STM32MP157AAC3	2×Cortex-A7@650MHz +Cortex-M4@209MHz	512MB DDR3L	4GB eMMC	Ethernet PHY	LCC 164PIN	0°C~+70°C	43×45mm	Linux Ubuntu	MYD-YA157C-V3-4E512D-65-C
MYC-YA157C-V3-4E512D-65-I							-40°C~+85°C			MYD-YA157C-V3-4E512D-65-I

● 核心板扩展信号

通信接口	RGMII、2×CAN FD、2×USB2.0、8×UART、6×SPI、6×I2C
多媒体接口	RGB、MIPI DSI、4×SAI、3×I2S
其他接口	2×16bit 20ch ADC、SWD

● 应用场景



商业HMI



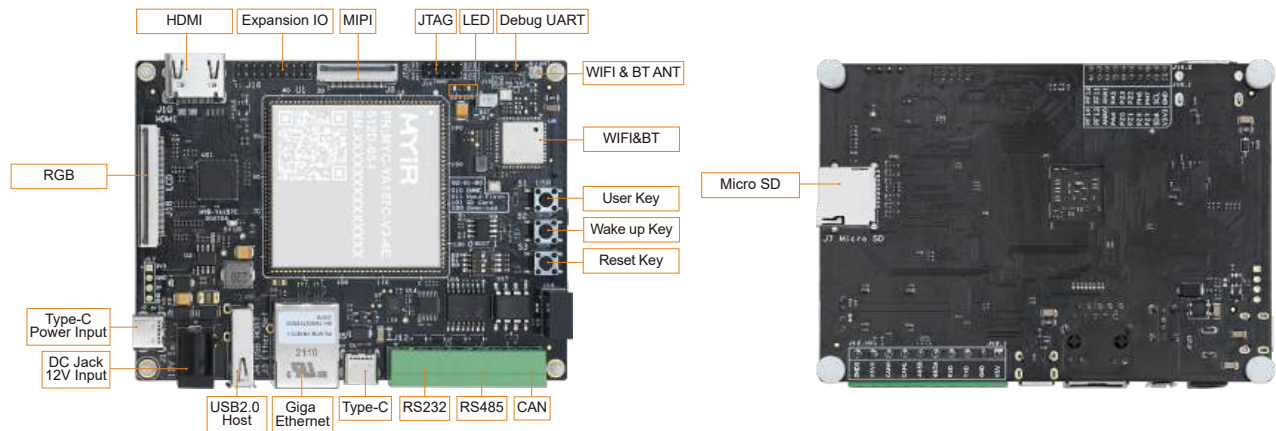
医疗器械



工业制造



石化



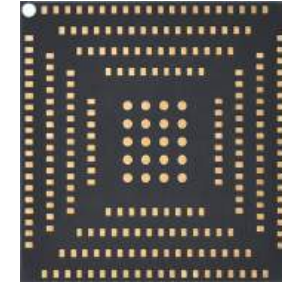
开发板正面标注图

开发板背面标注图



MYC-LD25X核心板

- 基于STM32MP257处理器，2×Cortex-A35@1.5GHz+Cortex-M33@400MHz
- 集成1.35 TOPS的NPU加速器和3D GPU，赋能低成本轻量级AI应用
- 接口丰富：3路千兆以太网接口、3路CAN FD、9路UART、8路SPI、7路I2C
- LGA封装，252PIN；工业级：-40°C~+85°C，尺寸37×39mm；系统Linux、Debian



扫一扫了解更多参数

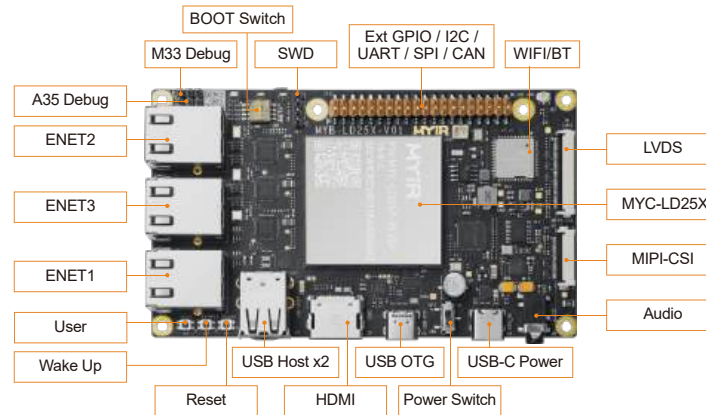
● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-LD257-8E1D-150-I	STM32MP257DAK3	2×Cortex-A35@1.5 GHz +Cortex-M33@400 MHz	1GB LPDDR4	8GB eMMC	256KBit EEPROM	LGA 252PIN	-40°C~+85°C	37×39mm	Linux Debian	MYD-LD257-8E1D-150-I
MYC-LD257-8E2D-150-I			2GB LPDDR4							MYD-LD257-8E2D-150-I

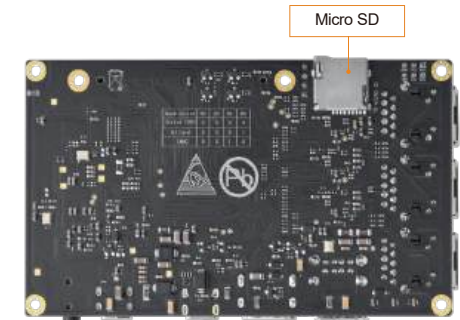
● 核心板扩展信号

通信接口	3×RGMII、USB2.0 HOST、USB3.0 OTG/PCIE2.0、4×USART、5×UART、8×SPI、7×I2C、4×I3C、3×CAN FD、2×SD/MCC
多媒体接口	Parallel RGB、MIPI DSI、LVDS、MIPI CSI、DCMI、4×SAI
其他接口	JTAG、SWD

● 应用场景



开发板正面标注图



开发板背面标注图

NXP | MYC-Y6ULX-V2核心板

- 基于NXP i.MX6UL/i.MX6ULL系列处理器，内核Cortex-A7@528MHz
- 入门级嵌入式系统高质量和高性价比核心平台，适合HMI、物联网网关等领域
- 接口丰富：2路百兆以太网接口、2路USB2.0接口、2路CAN、8路UART、4路SPI、4路I2C
- LCC封装，140PIN；商业级：0°C~+70°C，工业级：-40°C~+85°C，尺寸37×39mm，系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-Y6ULY2-V2-256N256D-50-C	MCIMX6Y2CVM05AB	Cortex-A7@528MHz	256MB DDR3	256MB Nand FLASH	Ethernet PHY	LCC 140PIN	0°C~+70°C	37×39mm	Linux	MYD-Y6ULY2-V2-256N256D-50-C
-40°C~+85°C							MYD-Y6ULY2-V2-256N256D-50-I			
0°C~+70°C			512MB DDR3	4GB eMMC			MYD-Y6ULY2-V2-4E512D-50-C			
-40°C~+85°C			256MB DDR3	256MB Nand FLASH			MYD-Y6ULY2-V2-4E512D-50-I			
MYC-Y6ULG2-V2-256N256D-50-I	MCIMX6G2CVM05AB									MYD-Y6ULG2-V2-256N256D-50-I

● 核心板扩展信号

通信接口	2×RMII、2×CAN、2×USB2.0、8×UART、4×SPI、4×I2C
多媒体接口	RGB、Parallel CSI、3×I2S
其他接口	2×12bit 10ch ADC、JTAG

● 应用场景



充电桩



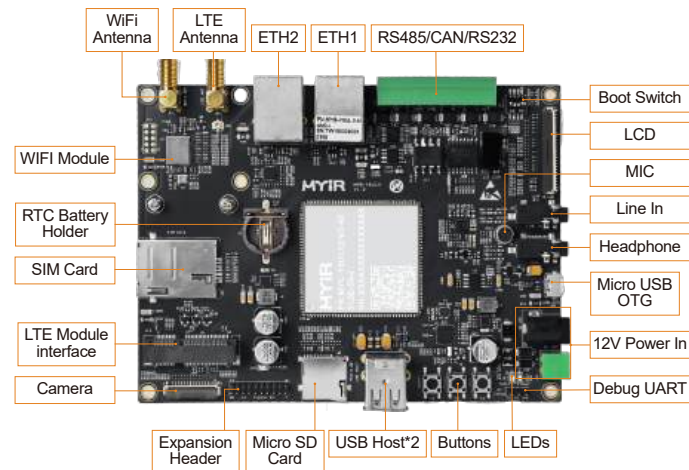
HMI



工业控制



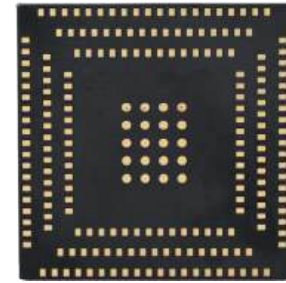
医疗器械



开发板正面标注图

NXP | MYC-LMX9X核心板

- 基于NXP i.MX 93处理器，2×Cortex-A55@1.7GHz+Cortex-M33@250MHz
- 集成0.5 TOPS NPU，赋能低成本轻量级AI应用
- 接口丰富：2路千兆以太网接口（1路支持TSN）、2路 CAN FD、8路UART、8路I2C、8路SPI
- LGA封装，218PIN；工业级：-40°C~+85°C，尺寸37×39mm；系统Linux、Debian



扫一扫了解更多参数

产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-LMX9352-8E1D-170-I	MIMX9352CVVXMAB	2×Cortex-A55@1.7GHz+ Cortex-M33@250MHz	1GB LPDDR4	8GB eMMC	256KBit EEPROM	LGA 218PIN	-40°C~+85°C	37×39mm	Linux Debian	MYD-LMX9352-8E1D-170-I
MYC-LMX9352-8E2D-170-I			2GB LPDDR4							MYD-LMX9352-8E2D-170-I

核心板扩展信号

通信接口	2×RGMII、2×CAN FD、2×USB2.0、8×UART、8×SPI、8×I2C、2×I3C
多媒体接口	MIPI DSI、LVDS、RGB、MIPI CSI、Parallel CSI、3×SAI
其他接口	12bit 4ch ADC、JTAG

应用场景



充电桩



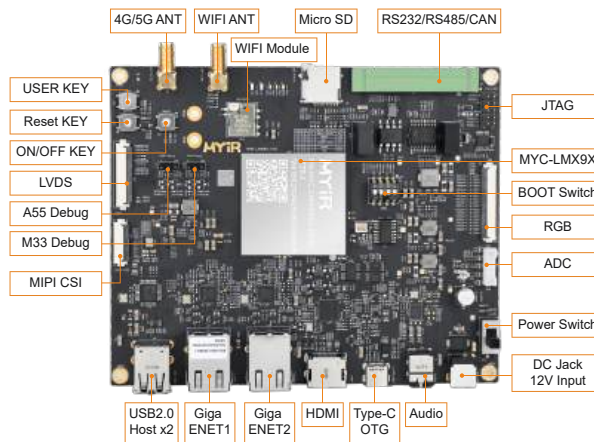
运动控制器



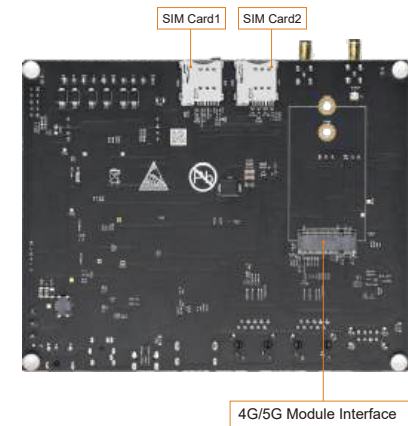
工程机械



医疗器械



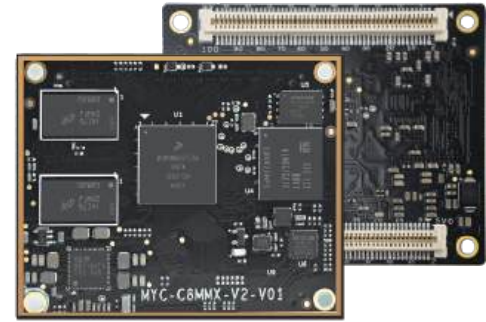
开发板正面标注图



开发板背面标注图

NXP | MYC-C8MMX-V2核心板

- 基于NXP i.MX8M Mini处理器，更高效的任務处理，内核4×Cortex-A53@1.8GHz+Cortex-M4@400MHz
- 主要应用于智能充电桩、人机互动、泛在电力物联网、工业及医疗、智能交通、智慧消防、智慧城市等领域
- 接口丰富：千兆以太网接口、2×USB2.0接口、PCIE2.0接口、4×UART、3×SPI、3×I2C
- B2B封装，200PIN；商业级：0°C~+70°C，工业级：-40°C~+85°C；尺寸49×60mm；系统Linux、Ubuntu、Android



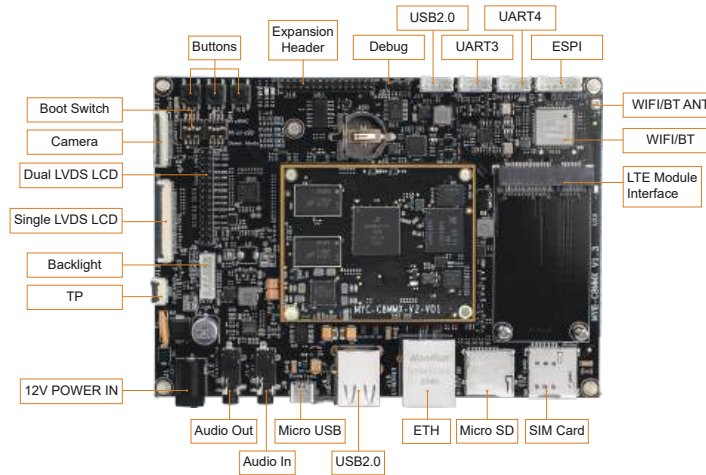
扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

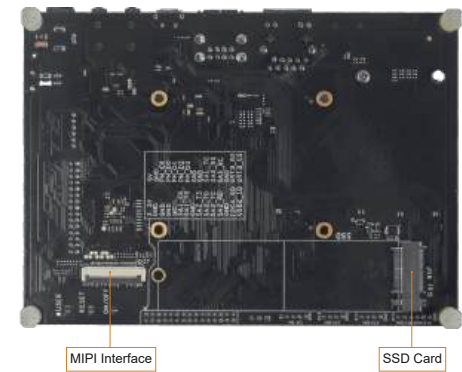
核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-180-C	MIMX8MM6DVTLZAA	4×Cortex-A53@1.8GHz +Cortex-M4@400MHz	2GB DDR4	8GB eMMC	Ethernet PHY 32MB QSPI FLASH	B2B 200PIN	0°C~+70°C	49×60mm	Linux Ubuntu Android	MYD-C8MMQ6-V2-8E2D-180-C
MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-160-I	MIMX8MM6CVTKZAA	4×Cortex-A53@1.6GHz +Cortex-M4@400MHz					-40°C~+85°C			MYD-C8MMQ6-V2-8E2D-160-I

● 核心板扩展信号

通信接口	RGMII、PCIE2.0、2×USB2.0、4×UART、3×SPI、3×I2C
多媒体接口	MIPI DSI、MIPI CSI、5×SAI
其他接口	JTAG



开发板正面标注图



开发板背面标注图

● 应用场景



商业HMI



医疗器械



工业控制



人工智能

NXP | MYC-JX8MPQ核心板

- 基于NXP i.MX 8M Plus处理器，2.3 TOPS算力，内核4×Cortex-A53@1.6GHz+Cortex-M7@800MHz
- 800MHz音频DSP、双摄像头（ISP）、3D GPU、AI相关软件DEMO丰富
- 接口丰富：2路千兆以太网接口、2路CAN FD接口、2路USB3.0接口、4路UART接口、3路SPI、6路I2C
- MXM封装，314PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸45×82mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型（其他配置可批量定制）

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-JX8MPQ-8E2D-160-I	MIMX8ML8CVNKZAB	4×Cortex-A53@1.6GHz +Cortex-M7@800MHz	2GB LPDDR4	8GB eMMC	32MB QSPI FLASH	MXM 314PIN	-40°C~+85°C	45×82mm	Linux	MYD-JX8MPQ-8E2D-160-I
MYC-JX8MPQ-8E4D-160-I			4GB LPDDR4							MYD-JX8MPQ-8E4D-160-I

● 核心板扩展信号

通信接口	2×RGMII、PCIE3.0、2×USB3.0、2×CAN FD、4×UART、3×SPI、6×I2C
多媒体接口	HDMI、MIPI-DSI、LVDS、2×MIPI CSI、6×SAI
其他接口	JTAG

● 应用场景



HMI



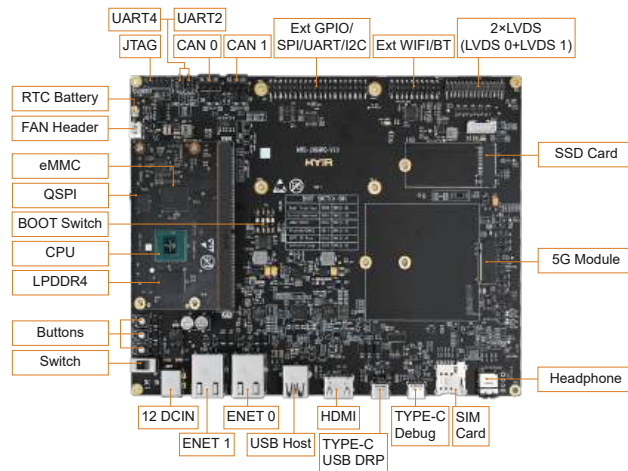
高性能AI设备



工业计算机



边缘计算



开发板正面标注图



开发板背面标注图

NXP | MYC-J1028X核心板

- 基于NXP LS1028A处理器，内核 2×Cortex-A72@1.5GHz
- 接口丰富：6路千兆以太网接口（支持TSN）、2个USB3.0接口、2路CAN FD、6路UART、3路SPI、1路SATA 3.0
- 支持DP显示，可支持DP1.3和eDP1.4，显示分辨率高达4K@60FPS
- MXM封装，314PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸45×82mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-J1028N-8E2D-150-I	LS1028AXN7PQA	2×Cortex-A72@1.5GHz	2GB DDR4	8GB eMMC	32Kbit EEPROM	MXM 314PIN	-40°C~+85°C	45×82mm	Linux Ubuntu	MYD-J1028N-8E2D-150-I

● 核心板扩展信号

通信接口	SGMII、QSGMII、RGMII、2×PCIE3.0、SATA 3.0、2×USB3.0、2×CAN FD、6×UART、3×SPI、8×I2C
多媒体接口	eDP、6×SAI
其他接口	JTAG

● 应用场景



汽车电子



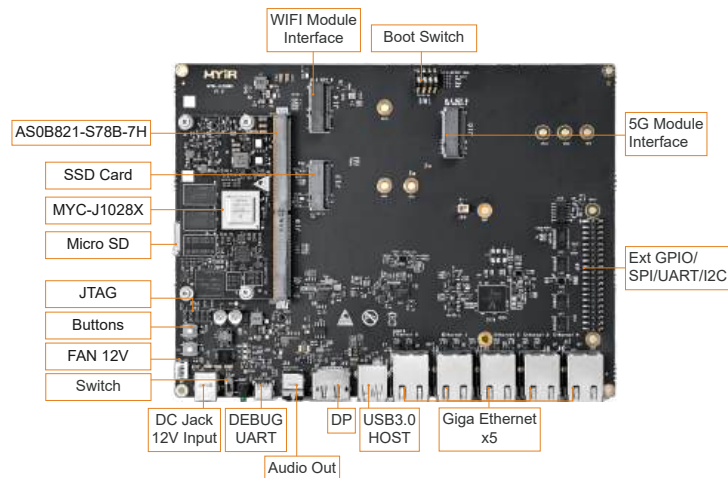
工业路由器



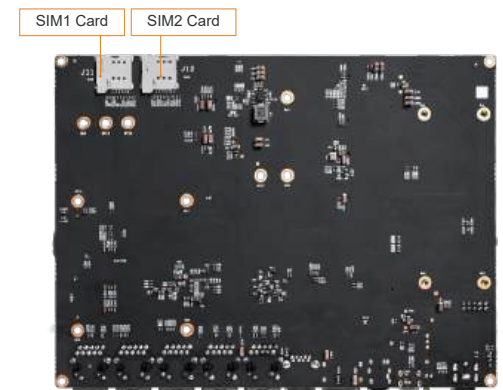
工业控制



边缘计算



开发板正面标注图



开发板背面标注图

NXP & AMD | MYC-JX8MMA7核心板

- CPU集成i.MX 8M Mini+ARTIX7处理器，内核4×Cortex-A53@1.8GHz+Cortex-M4@400MHz
- 二合一成本优势明显，高性能的ARM MPU+多媒体能力，良好LINUX UI界面的无缝交互
- 满足高速数据采集需求，ARM与FPGA之间采用PCIE高速通信，支持200~300MB/S的通信能力
- MXM封装，314PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸45×82mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-160-I	ARM: MIMX8MM6CVTKZAA FPGA: XC7A25T-2CSG325I	4×Cortex-A53@1.6GHz+ Cortex-M4@400MHz FPGA: 23K	ARM: 2GB LPDDR4	ARM: 8GB eMMC	32MB QSPI FLASH	MXM 314PIN	-40°C~+85°C	45×82mm	Linux	MYD-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-160-I
MYC-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-180-C	ARM: MIMX8MM6DVTLZAA FPGA: XC7A25T-2CSG325C	4×Cortex-A53@1.8GHz+ Cortex-M4@400MHz FPGA: 23K	FPGA: 256MB DDR3	FPGA: 32MB QSPI FLASH			0°C~+70°C			MYD-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-180-C

● 核心板扩展信号

通信接口	RGMII、2×USB2.0、4×UART、2×SPI、2×I2C、3×GTP
多媒体接口	MIPI DSI、MIPI CSI、3×SAI
其他接口	JTAG

● 应用场景



数据采集



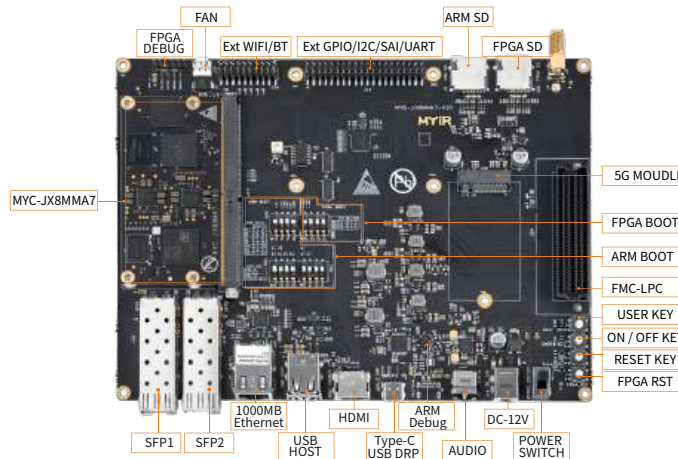
高端医疗



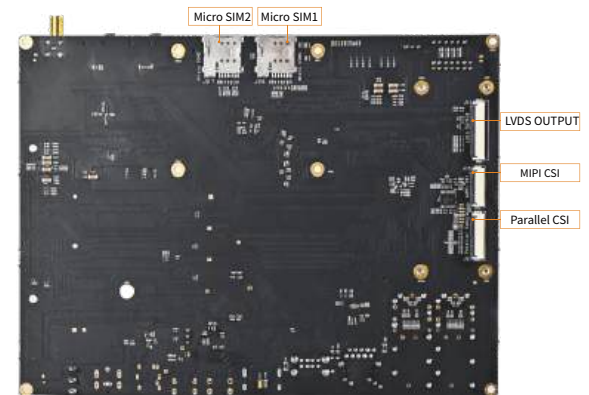
工业控制



工业网安



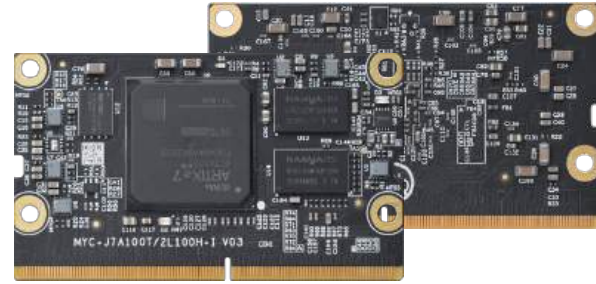
开发板正面标注图



开发板背面标注图

AMD | MYC-J7A100T核心板

- 采用Artix-7系列，可编程逻辑：101k Les, 126K DFF, 4.9Mb Bram, 240 DSP Slices
- 可编程IO：支持LVCMOS1.5V-3.3V, LVDS_18, LVDS_25; 285x IOs
- 高速接口：4路6.6Gb/s GTP, 1路PCIE GEN2 X 4
- MXM封装, 260PIN; 工业级: -40°C-85°C; 尺寸69.6×40mm



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-J7A100T-32Q512D-I	XC7A100T-2FGG484I	-	512MB DDR3	32MB QSPI	32KB EEPROM	MXM 260PIN	-40°C-85°C	69.6×40mm	-	MYD-J7A100T-32Q512D-I

● 核心板外投资源

项目	IO数量	描述
Bank 13	35	分bank引出178 HRIO
Bank14	45	
Bank15	48	
Bank16	50	
MGTP	4 pair	6.6Gb/s 串行收发器
JTAG	4	JTAG 调试

● 应用场景



通信设备



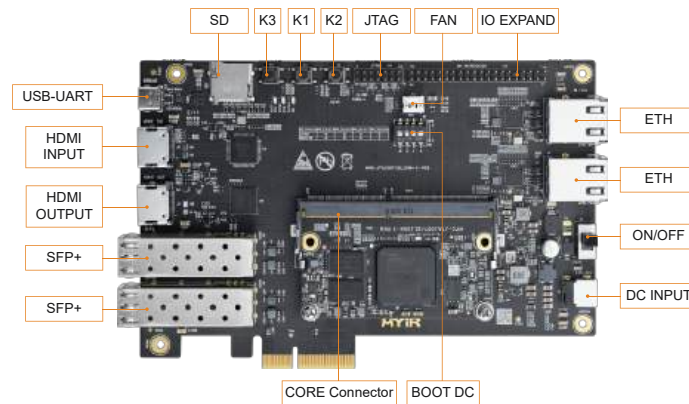
图像处理



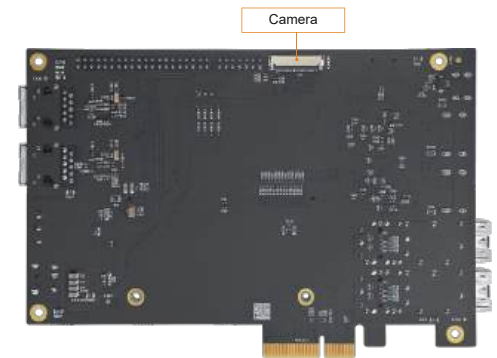
工业控制



医疗设备



开发板正面标注图



开发板背面标注图

AMD | MYC-C7Z010/20-V2核心板

- 基于AMD Zynq-7010/20高性能处理器，内核2×Cortex-A9@667/766MHz+Atrix 7 FPGA
- 1GBDDR, 4GB eMMC ,32MB QSPI flash; 极致选料与工艺标准,品质可靠
- 板载千兆以太网 PHY及USB PHY; 提供完善硬件参考&软件源码及教程, 助力产品开发
- B2B封装, 2×140PIN; 商业级: 0°C~+70°C, 工业级: -40°C~+85°C; 尺寸75×55mm; 系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-C7Z010-V2-4E1D-667-I	xc7z010-1clg400	2×Cortex-A9@667Hz +Atrix 7 FPGA (28K)	1GB DDR3	4GB eMMC	32MB QSPI Flash Ethernet PHY USB PHY	B2B 2×140PIN	-40°C~+85°C	75×55mm	Linux	MYD-C7Z010-V2-4E1D-667-I
MYC-C7Z020-V2-4E1D-766-I	xc7z020-2clg400	2×Cortex-A9@766Hz +Atrix 7 FPGA (85K)								MYD-C7Z020-V2-4E1D-766-I
MYC-C7Z010-V2-4E1D-667-C	xc7z010-1clg400	2×Cortex-A9@667Hz +Atrix 7 FPGA (28K)					MYD-C7Z010-V2-4E1D-667-C			
MYC-C7Z020-V2-4E1D-766-C	xc7z020-2clg400	2×Cortex-A9@766Hz +Atrix 7 FPGA (85K)					MYD-C7Z020-V2-4E1D-766-C			

● 核心板扩展信号

通信接口	RGMII、USB2.0、CAN、2×SPI、2×I2C、XADC
FPGA扩展IO	可扩展管脚数量141PIN(FPGA_XC7020)、114PIN(FPGA_XC7010)

● 应用场景



汽车行业



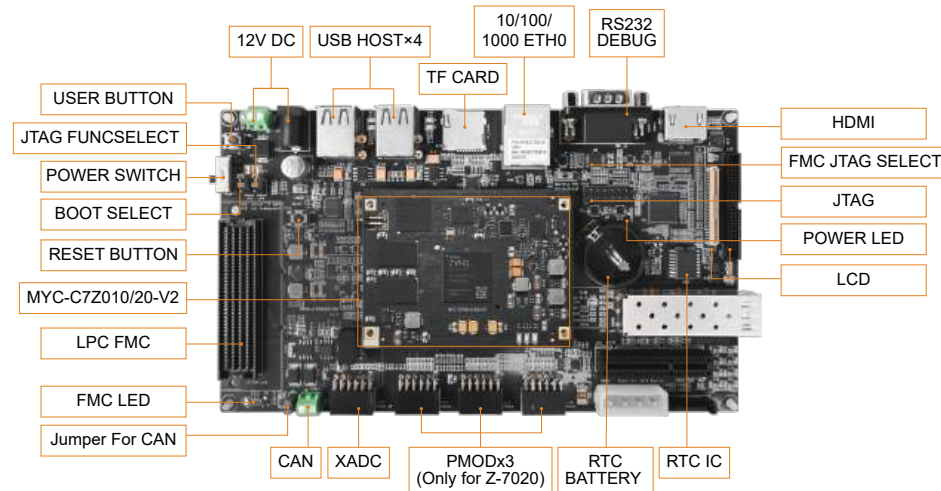
医疗器械



工业控制



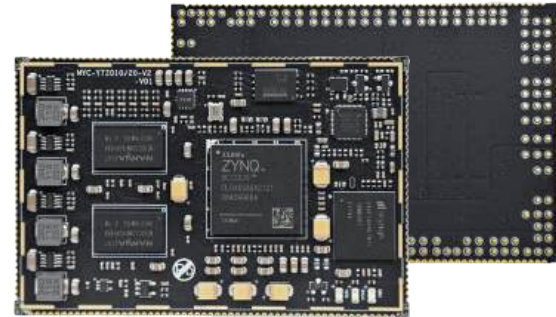
通信系统



开发板正面标注图

AMD | MYC-Y7Z010/20-V2核心板

- 基于AMD Zynq-7010/20高性能处理器，内核2×Cortex-A9@667/766MHz+Atrix 7 FPGA
- 512MB DDR, 4GB eMMC ,16MB QSPI flash; 极致选料与工艺标准,品质可靠
- 板载千兆以太网 PHY, 提供完善硬件参考&软件源码及教程, 助力产品开发
- LCC封装, 180PIN; 工业级: -40°C~+85°C; 尺寸75×50mm; 系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-Y7Z010-V2-4E512D-667-I	xc7z010-1clg400	2×Cortex-A9@667Hz +Atrix 7 FPGA (28K)	512MB DDR3	4GB eMMC	16MB QSPI Flash Ethernet PHY	LCC 180PIN	-40°C~+85°C	75×50mm	Linux	MYD-Y7Z010-V2-4E1D-667-I
MYC-Y7Z020-V2-4E512D-766-I	xc7z020-2clg400	2×Cortex-A9@766Hz +Atrix 7 FPGA (85K)								MYD-Y7Z020-V2-4E1D-766-I

● 核心板扩展信号

通信接口	RGMII、USB2.0、CAN、2×SPI、2×I2C、JTAG
FPGA扩展IO	可扩展管脚数量121PIN

● 应用场景



汽车行业



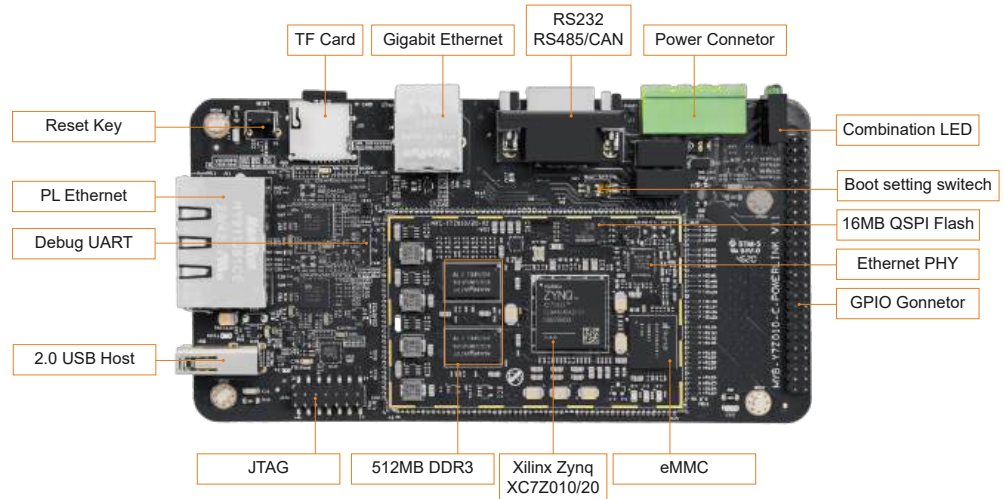
医疗器械



工业控制



人工智能



开发板正面标注图

AMD | MYC-C7Z015核心板

- 基于AMD Zynq-7015处理器、内核2×Cortex-A9@766MHz+Atrix 7 FPGA (74K) , 高性能高品质Zynq-7015计算平台
- 板载千兆以太网 PHY及USB PHY, 极致选料与工艺标准, 品质可靠
- 提供丰富的高速及通用接口, 为广泛应用提供设计参考
- B2B封装, 2×140PIN; 工业级: -40°C~+85°C; 尺寸75×55mm; 系统Linux



扫一扫了解更多参数

产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-C7Z015-4E1D-766-I	xc7z015-2clg485	2×Cortex-A9@766Hz +Atrix 7 FPGA (74K)	1GB DDR3	4GB eMMC	32MB QSPI Flash Ethernet PHY USB PHY	B2B 2×140PIN	-40°C~+85°C	75×55mm	Linux	MYD-C7Z015-4E1D-766-I

核心板扩展信号

通信接口	RGMII、USB2.0、CAN、2×SPI、2×I2C、2×XADC、SFP、PCIE、SATA
FPGA扩展IO	可扩展管脚数量137PIN(FPGA_XC7015)

应用场景



汽车行业



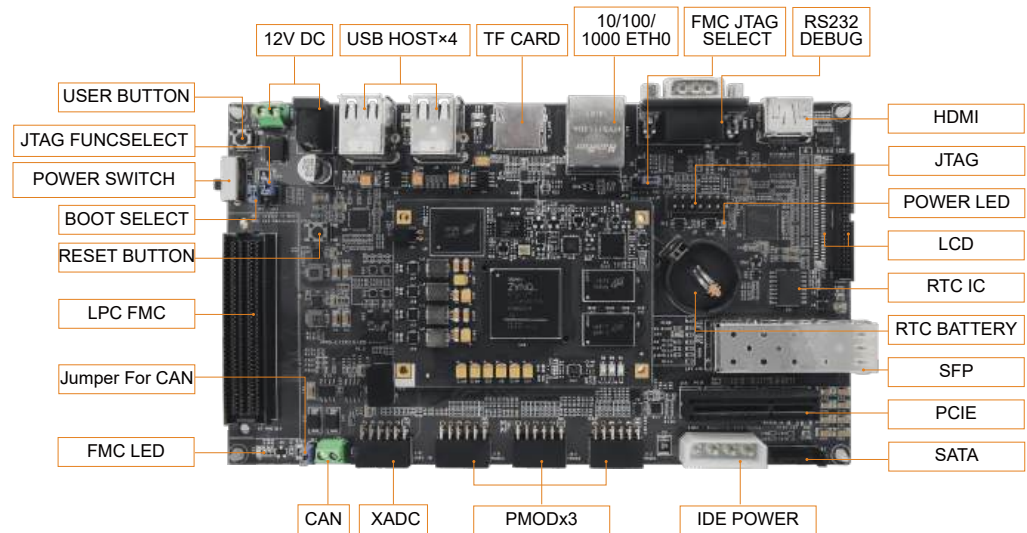
医疗器械



工业控制



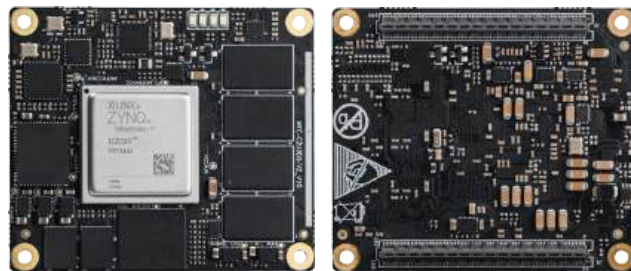
通信系统



开发板正面标注图

AMD | MYC-CZU3EG/4EV/5EV-V2核心板

- 基于AMD XCZU3EG/XCZU4EV/XCZU5EV处理器, ARM:4×A53@1200MHz+2×R5@533MHz+ UltraScale+ FPGA
- 每瓦性能提升5倍; 4GB DDR4 (64bit, 2400MHZ), 4GB eMMC, 128MB QSPI flash
- 搭载DPU AI引擎, 可提供强大AI计算能力, 结合DNNDK工具链, 为AI应用落地提供完整支撑
- B2B封装, 2×160PIN; 商业级: 0°C~+70°C, 工业级: -40°C~+85°C; 尺寸60×52mm; 系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-CZU3EG-V2-4E4D-1200-C	XCZU3EG-1SFVC784	ARM:4×A53@1200MHz+2×R5@533MHz + UltraScale+ FPGA 154K	4GB DDR4	4GB eMMC	128MB QSPI Flash Ethernet PHY USB PHY	高速B2B 2×160PIN	0°C~+70°C	60×52mm	Linux	MYD-CZU3EG-V2-4E4D-1200-C
MYC-CZU4EV-V2-4E4D-1200-I-FAN	XCZU4EV-2SFVC784	ARM:4×A53@1200MHz+2×R5@533MHz + UltraScale+ FPGA 192K					-40°C~+85°C			MYD-CZU4EV-V2-4E4D-1200-C (采用工业级核心板)
MYC-CZU5EV-V2-4E4D-1200-I-FAN	XCZU5EV-2SFVC784	ARM:4×A53@1200MHz+2×R5@533MHz + UltraScale+ FPGA 256K					-40°C~+85°C			MYD-CZU5EV-V2-4E4D-1200-C (采用工业级核心板)

● 核心板扩展信号

通信接口	RGMII、CAN、USB3.0、USB_UART、2×PMOD、PCIE2.0、DP SATA3.0、4×SFP(Only for 4EV/5EV)
FPGA扩展IO	可扩展管脚数量156PIN(FPGA)

● 应用场景



数据中心



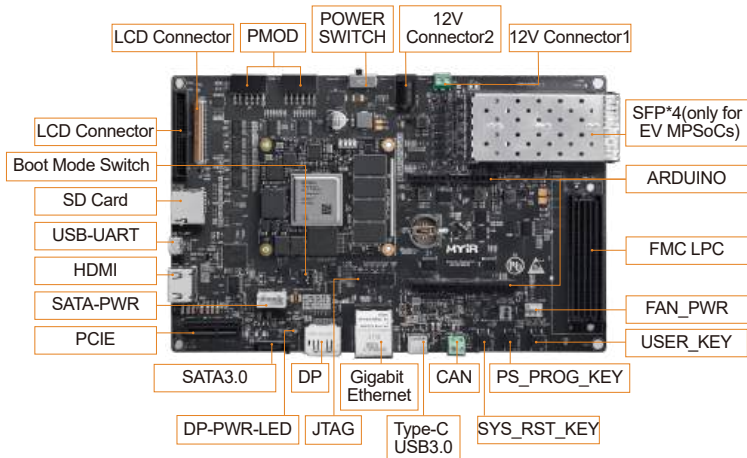
医疗器械



工业控制



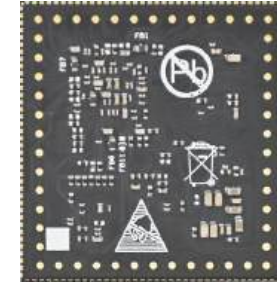
自动驾驶



开发板正面标注图

RENESAS | MYC-YG2UL核心板

- 基于RZ/G2UL处理器，通用64位工业MPU；内核Cortex-A55@1.0GHz +Cortex-M33@200MHz
- 16位DDR3L/DDR4接口以及LCD控制器
- 接口丰富：摄像头输入、显示输出、USB2.0和千兆以太网
- LCC+LGA封装，190PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸37×39mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-YG2UL-4E512D-100-I	R9A07G043U11GBG	Cortex-A55@1.0GHz+ Cortex-M33@200MHz	512MB DDR3	4GB eMMC	32Kbit EEPROM	LCC+LGA 190PIN	-40°C~+85°C	37×39mm	Linux OpenWrt	MYD-YG2UL-4E512D-100-I

● 核心板扩展信号

通信接口	2×RGMII, 2×CAN FD, 2×USB2.0, 7×UART, 3×SPI, 4×I2C
多媒体接口	RGB, MIPI CSI, 4×SSI
其他接口	12bit 2ch ADC, JTAG

● 应用场景



工业HMI



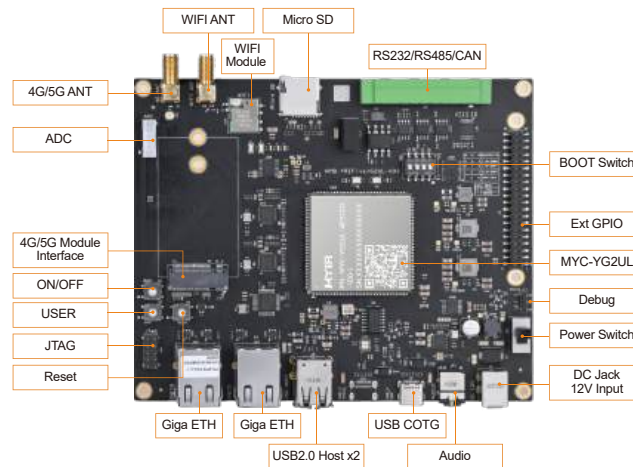
工业网关



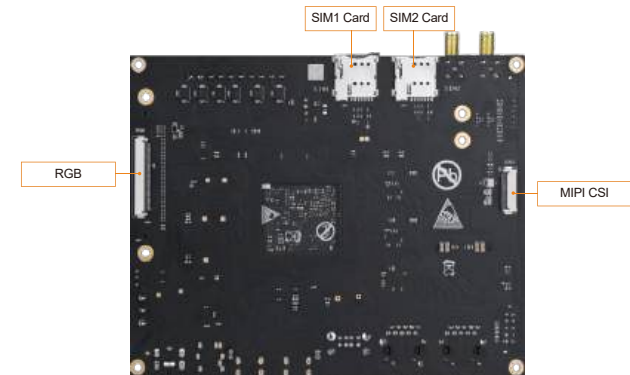
医疗器械



充电桩



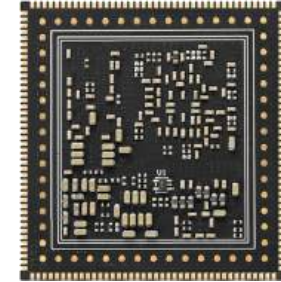
开发板正面标注图



开发板背面标注图

RENESAS | MYC-YG2LX核心板

- 基于瑞萨高性价比RZ/G2L处理器，2×Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz，满足高性能和实时性需求
- 具有极强的泛用性和易用性；丰富多媒体接口MIPI-DSI/RGB/MIPI-CSI/Parallel CSI
- 集成Arm Mali-G31 3D GPU，VPU支持H.264 1920*1080@30FPS视频编解码
- LCC+LGA封装，222PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸43×45mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-YG2L23-8E1D-120-I	R9A07G044L23GBG	2×Cortex-A55@1.2GHz+ Cortex-M33@200MHz	1GB DDR4	8GB eMMC	256Kbit EEPROM	LCC+LGA 222PIN	-40°C~+85°C	43×45mm	Linux Ubuntu	MYD-YG2L23-8E1D-120-I
MYC-YG2L23-8E2D-120-I			2GB DDR4							MYD-YG2L23-8E2D-120-I

● 核心板扩展信号

通信接口	2×RGMII, 2×CAN FD, 2×USB2.0, 7×UART, 3×SPI, 4×I2C
多媒体接口	RGB, MIPI DSI, Parallel CSI, MIPI CSI, 4×SSI, SRC
其他接口	12bit 8ch ADC, JTAG

● 应用场景



工业HMI



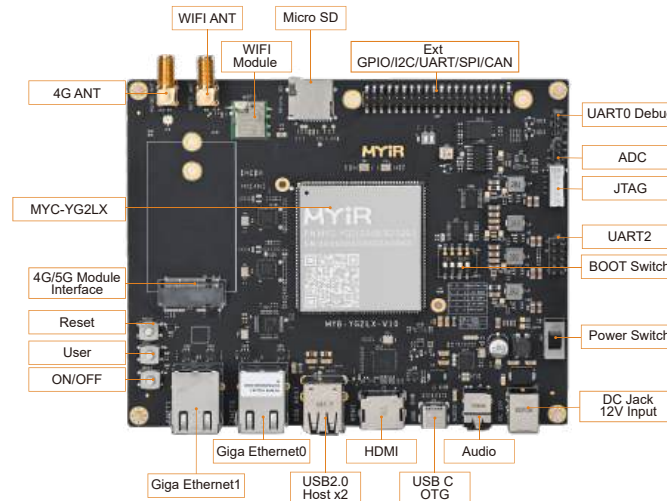
医疗器械



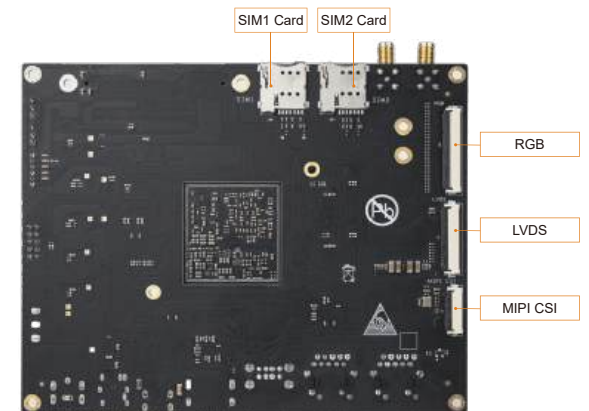
工业控制



能源电力



开发板正面标注图

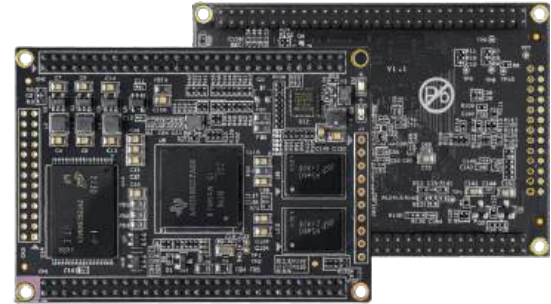


开发板背面标注图



MYC-C335X-V4核心板

- 基于TI AM335X处理器，兼容性强，易拓展，内核Cortex-A8@800MHz/1.0GHz
- 主要应用于包括游戏外设、充电桩计费控制单元、消费类医疗器械以及智能收费系统、智能售货机、称重系统等产品
- 接口丰富：2路千兆以太网接口、2路CAN接口、2路USB2.0接口、6路UART功能接口
- DIP封装，2×60PIN；商业级：0°C~+70°C，工业级：-40°C~+85°C；尺寸70×50mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-C3352-V4-256N256D-80-I	AM3352BZCZD80	Cortex-A8@800MHz	256MB DDR3	256MB Nand FLASH	Ethernet PHY 32Kbit EEPROM	DIP 2×60PIN	-40°C~+85°C	70×50mm	Linux	MYD-C3352-V4-256N256D-80-I
MYC-C3352-V4-512N512D-80-I			512MB DDR3	512MB Nand FLASH						0°C~+70°C
MYC-C3352-V4-512N512D-80-C			256MB DDR3	256MB Nand FLASH			-40°C~+85°C			MYD-C3352-V4-512N512D-80-C
MYC-C3358-V4-256N256D-100-I	AM3358BZCZA100	Cortex-A8@1.0GHz	256MB DDR3	256MB Nand FLASH			0°C~+70°C			MYD-C3358-V4-256N256D-100-I
MYC-C3358-V4-512N512D-100-I			512MB DDR3	512MB Nand FLASH			-40°C~+85°C			MYD-C3358-V4-512N512D-100-I
MYC-C3358-V4-512N512D-100-C			256MB DDR3	256MB Nand FLASH			0°C~+70°C			MYD-C3358-V4-512N512D-100-C
MYC-C3358-V4-512N512D-100-C			512MB DDR3	512MB Nand FLASH	0°C~+70°C	MYD-C3358-V4-512N512D-100-C				

● 核心板扩展信号

通信接口	2×RGMII、2×CAN、2×USB2.0、6×UART、2×SPI、3×I2C
多媒体接口	RGB、2×McASP
其他接口	12bit 8ch ADC、JTAG

● 应用场景



充电桩计费控制



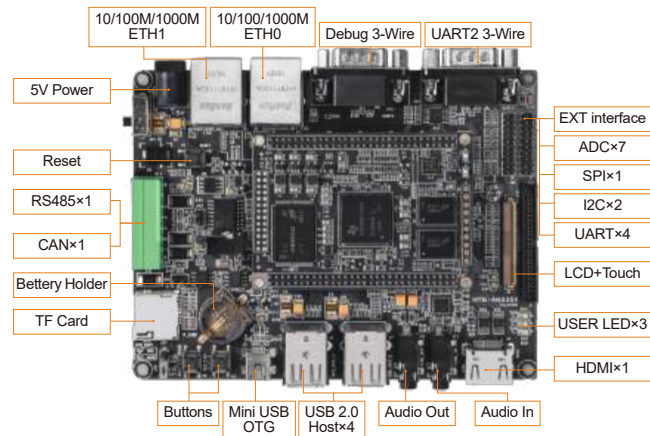
医疗器械



工业领域



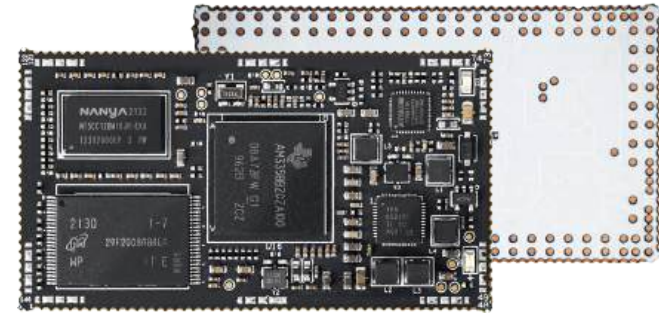
游戏外设



开发板正面标注图

TEXAS INSTRUMENTS | MYC-Y335X-V2核心板

- 基于TI AM335x处理器，兼容性强，易拓展，内核Cortex-A8@800MHz/1.0GHz
- 主要应用于包括游戏外设、充电桩计费控制单元、消费类医疗器械以及智能收费系统、智能售货机、等产品
- 接口丰富：2路千兆以太网接口、2路CAN接口、2路USB2.0接口、6路UART功能接口；
- LCC封装，146PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸65×35mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

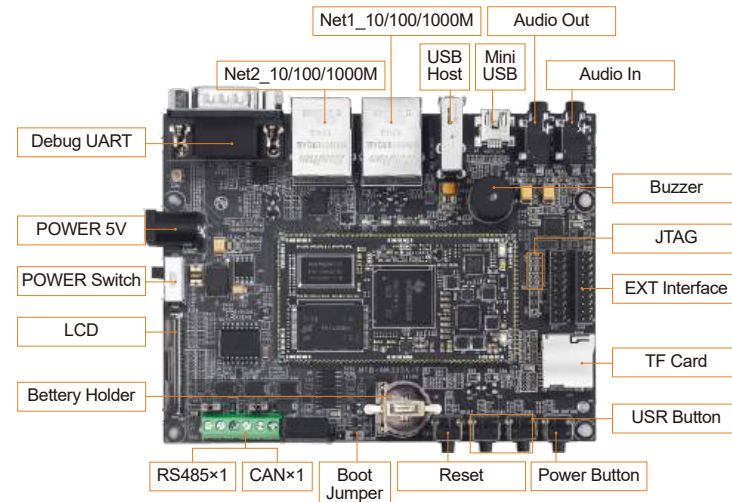
● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-Y3352-V2-256N256D-80-I	AM3352BZCZD80	Cortex-A8@800MHz	256MB DDR3	256MB Nand FLASH	Ethernet PHY 32Kbit EEPROM	LCC 146PIN	-40°C~+85°C	65×35mm	Linux	MYD-Y3352-V2-256N256D-80-I
MYC-Y3358-V2-256N256D-100-I	AM3358BZCZA100	Cortex-A8@1.0GHz								MYD-Y3358-V2-256N256D-100-I

● 核心板扩展信号

通信接口	2×RGMII, 2×CAN, 2×USB2.0, 6×UART, 2×SPI, 3×I2C
多媒体接口	RGB, 2×McASP
其他接口	2×12bit 8ch ADC, JTAG

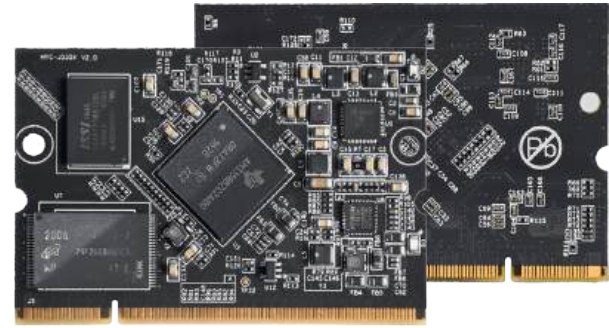
● 应用场景



开发板正面标注图

TEXAS INSTRUMENTS | MYC-J335X-V2核心板

- 基于TI AM335x处理器，内核 Cortex-A8@800MH/1.0GHz
- 主要应用于包括游戏外设、充电桩计费控制单元、消费类医疗器械以及智能收费系统、智能售货机、称重系统等产品
- 接口丰富：2路千兆以太网接口、2路CAN接口、2路USB2.0接口、6路UART功能接口、2路SPI
- MXM封装，200PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸67×45mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

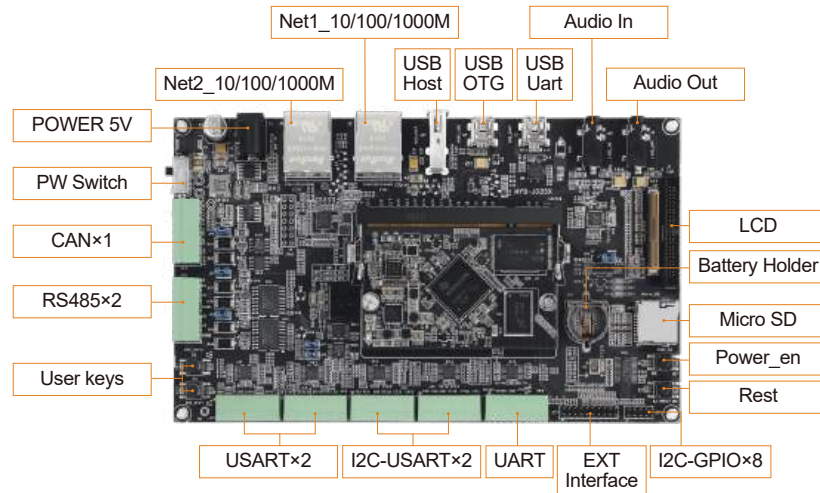
● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-J3352-V2-256N256D-80-I	AM3352BZCZD80	Cortex-A8@800MHz	256MB DDR3	256MB Nand FLASH	Ethernet PHY 32Kbit EEPROM	MXM 200PIN	-40°C~+85°C	67×45mm	Linux	MYD-J3352-V2-256N256D-80-I
MYC-J3358-V2-256N256D-100-I	AM3358BZCZA100	Cortex-A8@1.0GHz								MYD-J3358-V2-256N256D-100-I

● 核心板扩展信号

通信接口	2×RGMII, 2×CAN, 2×USB2.0, 6×UART, 2×SPI, 3×I2C
多媒体接口	RGB, 2×McASP
其他接口	12bit 8ch ADC, JTAG

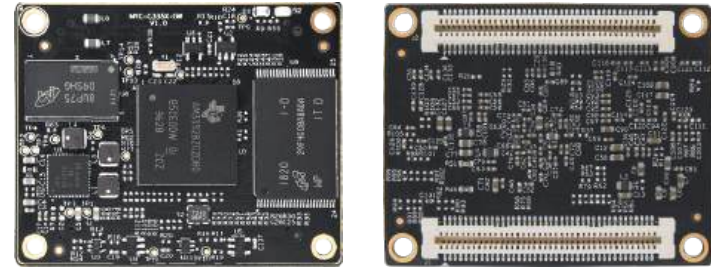
● 应用场景



开发板正面标注图

TEXAS INSTRUMENTS | MYC-C335X-GW核心板

- 基于TI AM335x处理器，内核 Cortex-A8@800MHz
- 支持光口，WiFi/蓝牙，4G LTE等高速通信应用接口；提供Linux以及MYIR MEasy IOT Demo软件支持
- 接口丰富：2路千兆以太网接口、2路CAN接口、2路USB2.0接口、6路UART功能接口
- B2B封装，2×80PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸50×40mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-C3354-256N256D-80-I-GW	AM3354BZCZD80	Cortex-A8@800MHz	256MB DDR3L	256MB Nand Flash	32Kbit EEPROM	B2B 2×80PIN	-40°C~+85°C	50×40mm	Linux	MYD-C3354-256N256D-80-I-GW
MYC-C3354-4E512D-80-I-GW			512MB DDR3L	4GB eMMC						MYD-C3354-4E512D-80-I-GW

● 核心板扩展信号

通信接口	2×RGMII, 2×CAN, 2×USB2.0, 6×UART, 2×SPI, 3×I2C
多媒体接口	RGB, 2×McASP
其他接口	12bit 8ch ADC, JTAG

● 应用场景



工业网关



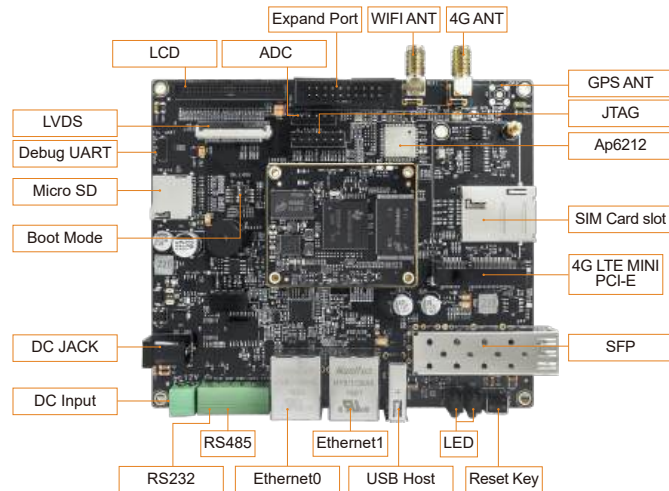
HMI



医疗器械



工业控制

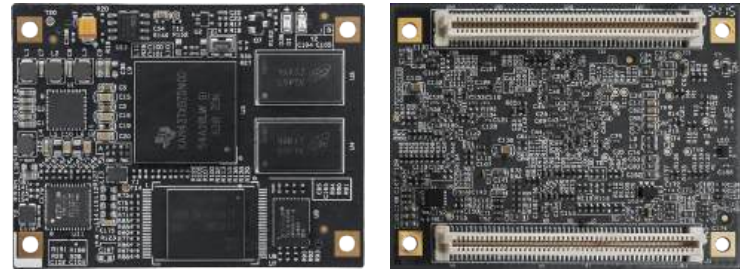


开发板正面标注图



MYC-C437X-V2核心板

- 基于TI AM437x处理器，可应用导航设备、条形扫描仪等产品，内核Cortex-A9@1.0GHz
- 基于高性能ARM Cortex-A9 32位RISC为核心，运行速度最高达1GHz，并提供3D图形加速和摄像机并行端口
- 接口丰富：2路千兆以太网接口、2路USB2.0接口、6路UART、2路CAN、2路SPI、3路I2C
- B2B封装，200PIN；商业级：0°C~+70°C，工业级：-40°C~+85°C；尺寸45×60mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-C4378-V2-4E512D-100-C	AM4378BZDND100	Cortex-A9@1.0GHz	512MB DDR3	4GB eMMC	Ethernet PHY 256Kbit EEPROM	B2B 200PIN	0°C~+70°C	45×60mm	Linux	MYD-C4378-V2-4E512D-100-C
MYC-C4378-V2-4E512D-100-I							-40°C~+85°C			MYD-C4378-V2-4E512D-100-I
MYC-C4377-V2-4E512D-100-I	AM4377BZDND100	-	-	-	-	-	-			-

● 核心板扩展信号

通信接口	2×RGMII, 2×CAN, 2×USB2.0, 6×UART, 2×SPI, 3×I2C
多媒体接口	RGB, 2×Parallel CSI, 2×McASP
其他接口	2×12bit 8ch ADC, JTAG

● 应用场景



工业HMI



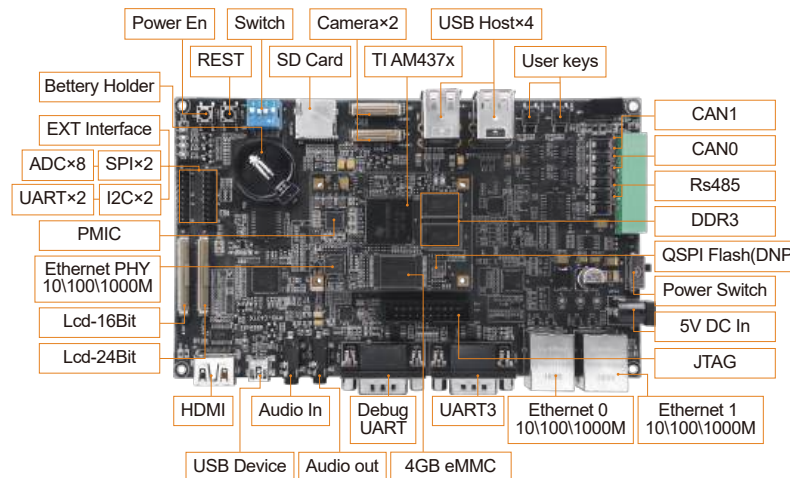
医疗器械



工业领域



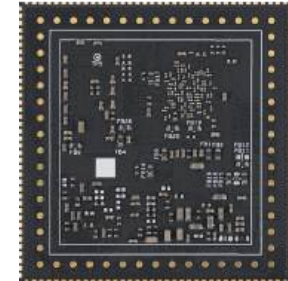
扫码仪



开发板正面标注图

TEXAS INSTRUMENTS | MYC-YM62X核心板

- AM62x是TI在智能工控领域高性能、超高效处理器，内核1/2/4×Cortex-A53@1.4GHz+Cortex-M4F@400MHz
- 3D GPU图形加速器，支持OpenGL 3.x/2.0/1.1、Vulkan 1.2图形加速引擎，支持双屏异显，支持1080P高清显示
- 接口丰富：2路显示控制器、2个千兆以太网、3路原生CAN FD、支持并行总线GPMC
- LCC+LGA封装，222PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸43×45mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他存储	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-YM6254-8E2D-140-I	AM6254ATCGGAALW	4×Cortex-A53@1.4GHz+ Cortex-M4F@400MHz	2GB DDR4							MYD-YM6254-8E2D-140-I
MYC-YM6252-8E1D-140-I	AM6252ATCGGAALW	2×Cortex-A53@1.4GHz+ Cortex-M4F@400MHz	1GB DDR4	8GB eMMC	32Kbit EEPROM	LCC+LGA 222PIN	-40°C~+85°C	43×45mm	Linux	MYD-YM6252-8E1D-140-I
MYC-YM6231-8E1D-140-I	AM6231ASGGGAALW	Cortex-A53@1.4GHz+ Cortex-M4F@400MHz	1GB DDR4							MYD-YM6231-8E1D-140-I

● 核心板扩展信号

通信接口	2×RGMII、2×USB 2.0、9×UART、3×CAN FD、4×I2C、5×SPI
多媒体接口	2×LVDS、1×RGB、1×MIPI CSI、3×MCASP
其他接口	1×GPMC、1×JTAG

● 应用场景



工业HMI



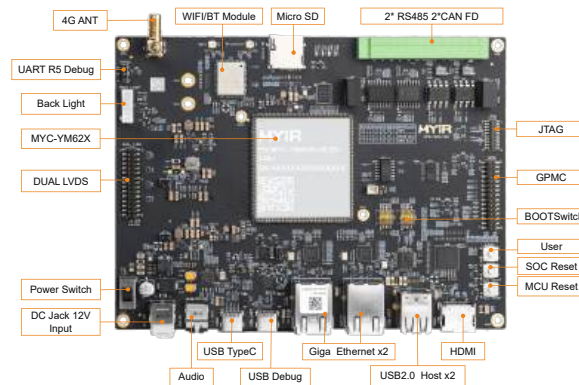
医疗器械



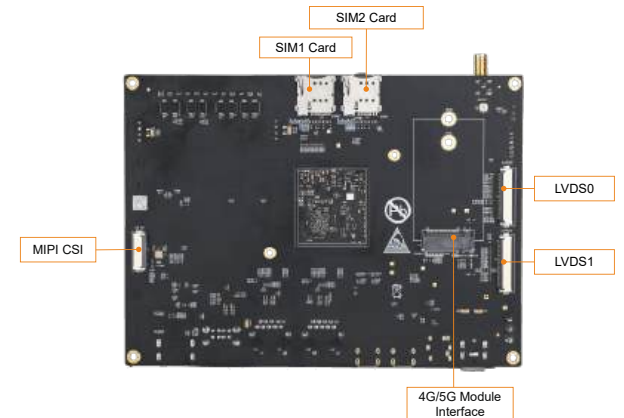
工业控制



能源电力



开发板正面标注图



开发板背面标注图

ALLWINER | MYC-YT113i核心板

- 基于全志T113-i处理器，内核 2×Cortex-A7@1.2GHz+RISC-V@800MHz
- 100%国产物料，核心板采用高密度高速电路板设计，板卡采用8层高密度PCB设计，独立的接地信号层，无铅
- 接口丰富：1路千兆以太网、2路USB2.0、6路UART、2路CAN、8路PWM、1路GPADC、4路TPADC
- LCC+LGA封装，140+50PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸37×39mm；系统Linux、Ubuntu



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-YT113i-4E256D-110-I	T113-i	2×Cortex-A7@1.2G +RISC-V@800MHz	256MB DDR3	4GB eMMC	32Kbit EEPROM	LCC+LGA 140+50PIN	-40°C~+85°C	37×39mm	Linux Ubuntu	MYD-YT113i-4E256D-110-I
MYC-YT113i-4E512D-110-I			512MB DDR3							MYD-YT113i-4E512D-110-I
MYC-YT113i-8E512D-110-I			1GB DDR3	8GB eMMC						MYD-YT113i-8E512D-110-I
MYC-YT113i-8E1D-110-I				MYD-YT113i-8E1D-110-I						

● 核心板扩展信号

通信接口	千兆以太网、2×USB2.0、6×UART、2×CAN、SDIO、SPI、4×I2C、8×PWM
多媒体接口	MIPI DSI、RGB DSI、Dual link LVDS、CVBS OUT、Parallel CSI、2×I2S

● 应用场景



商业显示



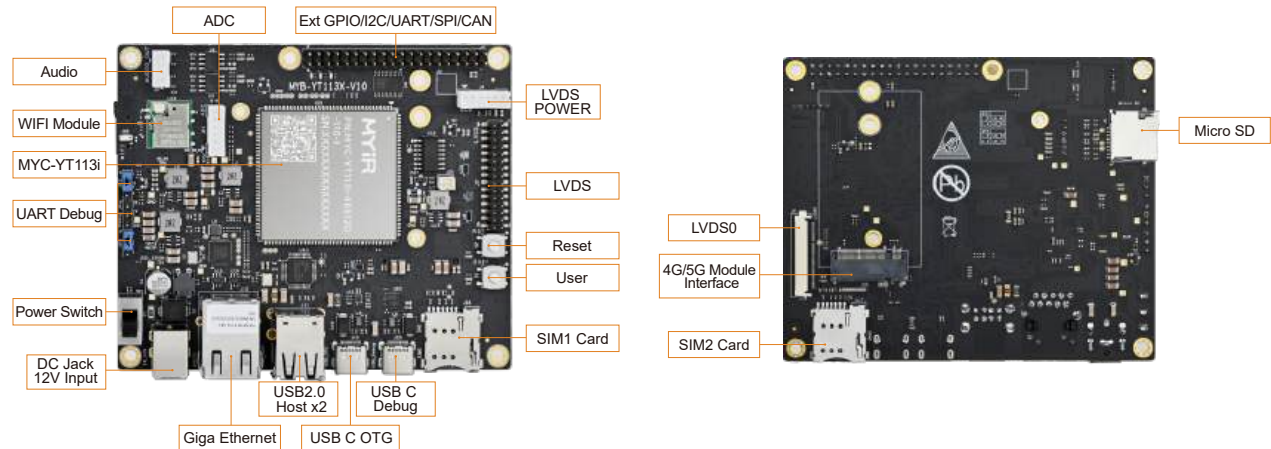
医疗器械



工业控制



能源电力



开发板正面标注图

开发板背面标注图

ALLWINNER | MYC-YT113X核心板

- 基于全志T113-S3入门级处理器，内核2×Cortex-A7@1.2GHz
- 适用于低成本网关产品和商业显示产品，具有丰富多媒体接口MIPI-DSI/RGB/LVDS/Parallel CSI，支持1080P@60FPS
- 接口丰富：千兆以太网接口、2路CAN接口、2路USB2.0接口、6路UART功能接口
- LCC封装，140PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸37×39mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-YT113S3-256N128D-110-I	T113-S3	2×Cortex-A7@1.2GHz	128MB DDR3	256MB Nand Flash	32Kbit EEPROM	LCC 140PIN	-40°C~+85°C	37×39mm	Linux	MYD-YT113S3-256N128D-110-I
MYC-YT113S3-4E128D-110-I				4GB eMMC						MYD-YT113S3-4E128D-110-I

● 核心板扩展信号

通信接口	千兆以太网、2×USB2.0、6×UART、2×CAN、SDIO、2×SPI、4×I2C、8×PWM
多媒体接口	MIPI DSI、RGB DSI、2×LVDS、Parallel CSI、2×I2S

● 应用场景



商业显示



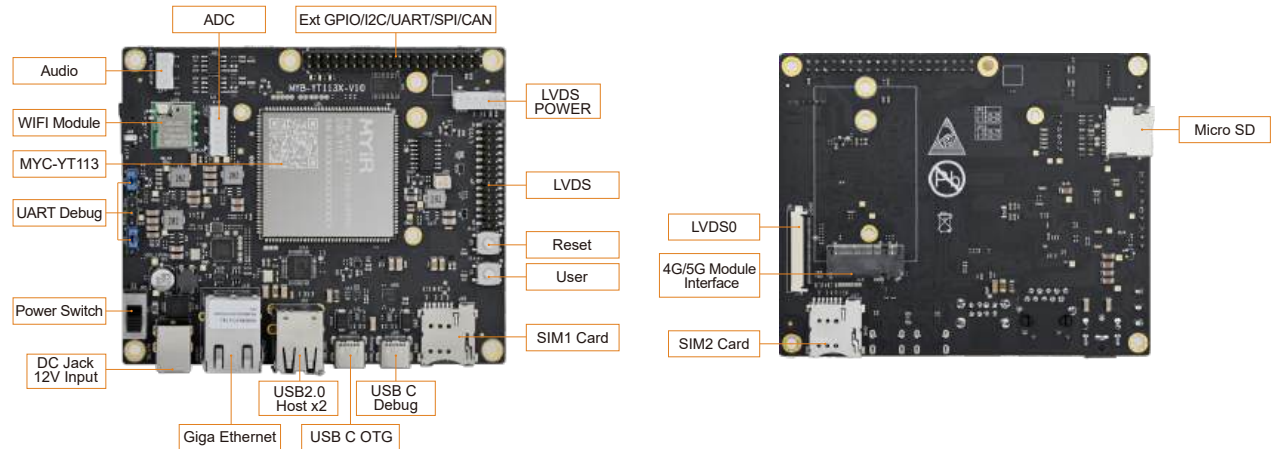
医疗器械



工业控制



能源电力

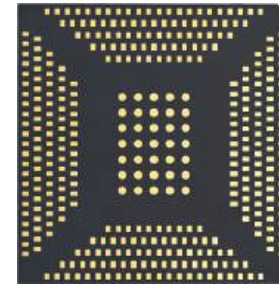


开发板正面标注图

开发板背面标注图

ALLWINER | MYC-LT536核心板

- 基于全志T536处理器，4×Cortex-A55@1.6GHz+RISCV@600MHz，
- 原生4路CAN FD接口，17路UART接口，Localbus接口，PCIE2.0，USB3.1，
- 2Tops NPU可选(T536MX-CEN2)、Graphic 2D，助力轻量级AI边缘计算应用
- LGA 381PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸43×45mm；系统Linux、电鸿



扫一扫了解更多参数

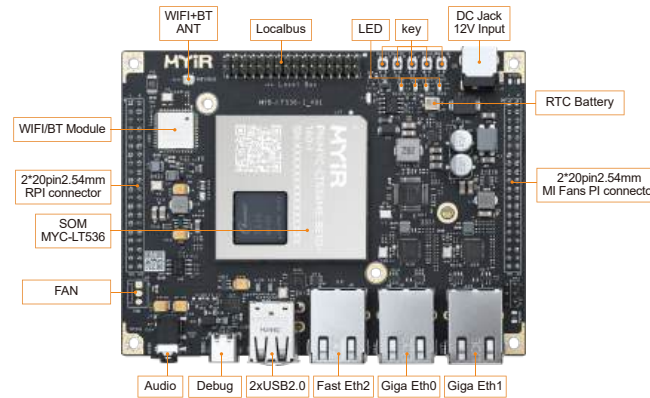
● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-LT536ME-8E1D-160-I	T536MX-CEX	4×Cortex-A55@1.6GHz+RISCV@600MHz	1GB LPDDR4	8GB eMMC	32KBit EEPROM	LGA 381PIN	-40°C~+85°C	43×45 mm	Linux Debian	MYD-LT536ME-8E1D-160-I-GK
MYC-LT536ME-16E2D-160-I			2GB LPDDR4	16GB eMMC						MYD-LT536ME-16E2D-160-I-GK
MYC-LT536MN2-32E4D-160-I	T536MX-CEN2	4×Cortex-A55@1.6GHz+RISCV@600MHz, 2Tops NPU	4GB LPDDR4	32GB eMMC						MYD-LT536MN2-32E4D-160-I-GK

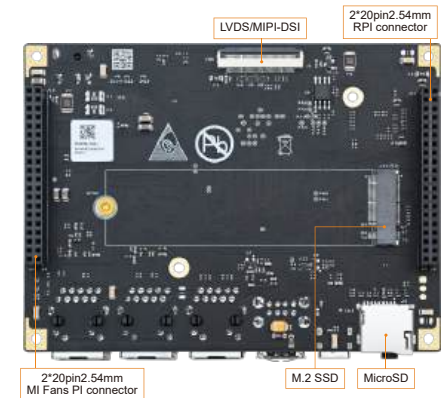
● 核心板扩展信号

通信接口	2×RGMII, USB3.1 DRD/PCIE2.0, 2×USB2.0, Localbus 4×CAN FD, 17×UART
多媒体接口	LVDS, MIPI DSI, Parallel DSI, 4×I2S
其他接口	9×I2C, 34×PWM, 6×SPI, SDIO, 26×12bit GPADC

● 应用场景



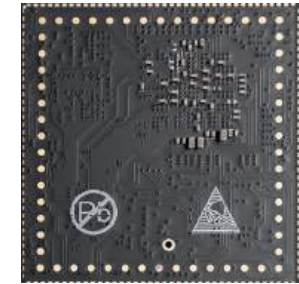
开发板正面标注图



开发板背面标注图

ALLWINER | MYC-YT507H核心板

- 基于全志T507-H处理器，四核Cortex-A53@1.5GHz，符合汽车AEC-Q100测试要求
- 支持4K@60FPS H.265视频解码，支持4K@25FPS H.264视频编码
- 可支持双屏同显、双屏异显，支持MIPI CSI、DVP摄像头输入；
- LCC+LGA封装，222PIN；商业级：0°C~+70°C，工业级：-40°C~+85°C；尺寸43×45mm；系统Linux、Android、Ubuntu



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-YT507H-8E1D-150-C	T507H	4×Cortex-A53@1.5GHz	1GB LPDDR4	8GB eMMC	32kbit EEPROM	LCC+LGA 222PIN	0°C~+70°C	43×45mm	Linux Android Ubuntu	MYD-YT507H-8E1D-150-C
MYC-YT507H-8E1D-150-I							-40°C~+85°C			MYD-YT507H-8E1D-150-I
MYC-YT507H-8E2D-150-C			0°C~+70°C				MYD-YT507H-8E2D-150-C			
MYC-YT507H-8E2D-150-I			-40°C~+85°C				MYD-YT507H-8E2D-150-I			

● 核心板扩展信号

通信接口	千兆以太网、4×USB2.0、6×UART、2×SDIO、2×SPI、4×I2C、6×PWM、5×ADC
多媒体接口	HDMI、2×LVDS、RGB24、TV CVBS、Parallel CSI、MIPI CSI、3×I2S、SPDIF

● 应用场景



商业显示



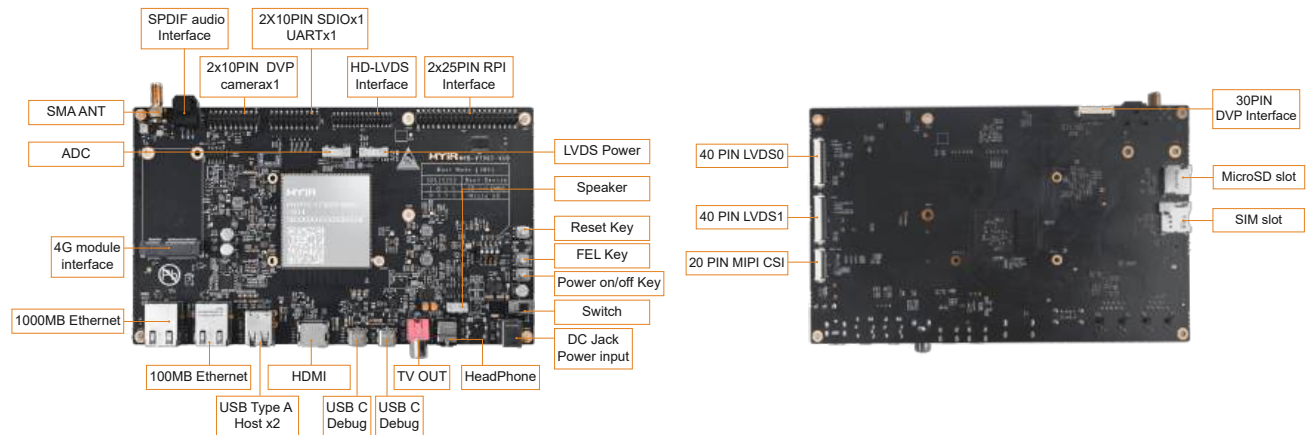
医疗器械



工业控制



智能终端

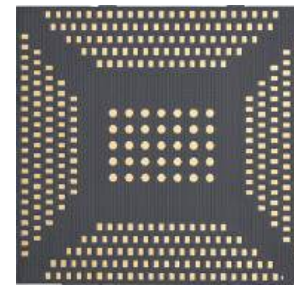


开发板正面标注图

开发板背面标注图

ALLWINER | MYC-LT527核心板

- 基于全志T527处理器，4×Cortex-A55@1.8GHz+4×Cortex-A55@1.4GHz，RISC-V@200MHz
- 多媒体功能强大：具备G57 GPU、4K编解码VPU、HiFi4 DSP，支持4~6路Camera
- 支持多种显示接口：HDMI、DP、LVDS、MIPI-DSI和RGB并口，支持4K+1080P双异显
- LGA封装，381PIN；工业级：-40°C~-+85°C；尺寸43×45mm；系统Linux、Android、Ubuntu、OpenHarmony



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC- LT527MN-16E2D-180-I-G	LT527MN	4×Cortex-A55@1.8GHz +4×Cortex-A55@1.4GHz RISC-V@200MHz, 2Tops NPU	2GB LPDDR4	16GB eMMC	32kbit EEPROM	LGA 381PIN	-40°C~-+85°C	43×45mm	Linux Android Ubuntu OpenHarmony	-
MYC- LT527MN-32E4D-180-I-G			4GB LPDDR4	32GB eMMC						MYD- LT527MN-32E4D-180-I-GK
MYC- LT527M-16E2D-180-I-G	LT527M	4×Cortex-A55@1.8GHz +4×Cortex-A55@1.4GHz RISC-V@200MHz	2GB LPDDR4	16GB eMMC	32kbit EEPROM	LGA 381PIN	-20°C~-+70°C	43×45mm	Linux Android Ubuntu OpenHarmony	MYD- LT527M-16E2D-180-I-GK
MYC- LT527M-8E1D-180-I-G			1GB LPDDR4	8GB eMMC						-
MYC- LT527M-16E2D-180-E			2GB LPDDR4	16GB eMMC						MYD- LT527M-16E2D-180-E

● 核心板扩展信号

通信接口	2×千兆以太网、USB3.0、2×USB2.0、1×PCIe2.1、10×UART 2×CAN2.0、3×SDIO、4×SPI、9×I2C、30×PWM、24×ADC
多媒体接口	HDMI2.0、eDP1.3、2×MIPI-DSI、2×Dual VLDS、Parallel DSI、 2×MIPI CSI、Parallel CSI、4×I2S/TDM

● 应用场景



智慧商显



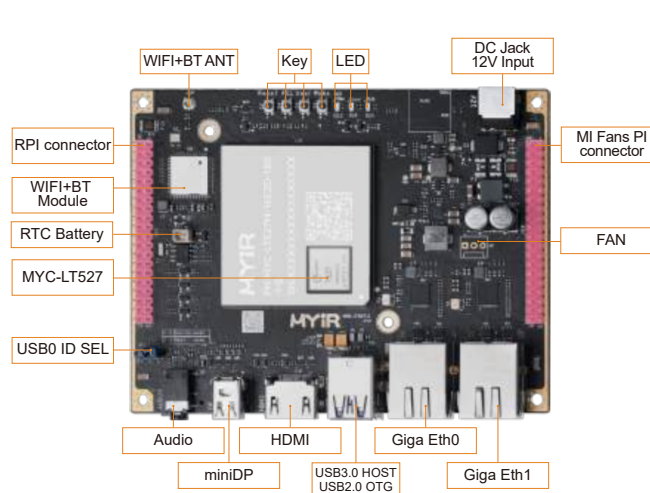
边缘智能盒子



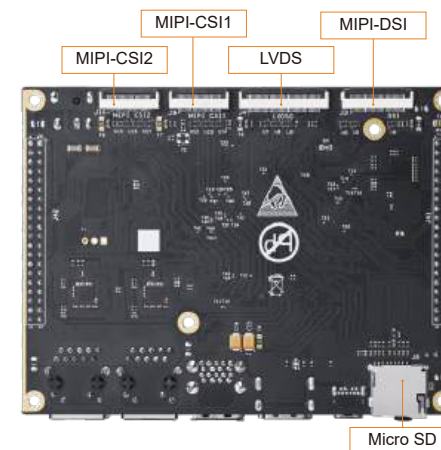
工业机器人



车载终端



开发板正面标注图



开发板背面标注图



MYC-JD9340核心板

- 基于国产芯驰D9处理器，内核4×Cortex-A55@1.6GHz+2×Cortex-R5@800MHz
- 低功耗：TSMC 车规工业16nm FinFET 先进工业保证相对较低的功耗；LINUX+RTOS系统，可以实现500ms冷启动显示
- 高可靠性：芯片结温支持范围从-40到125摄氏度，满足AEC-Q100车规级应用
- MXM封装，314PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸82×45mm；系统Linux、Android、FreeRTOS、Ubuntu



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-JD9340-16E2D-160-I	D9	4×Cortex-A55@1.6GHz +2×Cortex-R5@800MHz	2GB LPDDR4	16GB eMMC	E2PROM	MXM 314PIN	-40°C~+85°C	82×45mm	Linux Android FreeRTOS Ubuntu	MYD-JD9340-16E2D-160-I

● 核心板扩展信号

通信接口	2×千兆以太网，支持TSN、2×USB3.0、2×PCIe3.0、16×UART、4×CAN FD、2×SDIO、8×SPI、12×I2C、8×PWM、4×ADC
多媒体接口	MIPI DSI、LVDS、MIPI CSI、Parallel CSI

● 应用场景



工业HMI



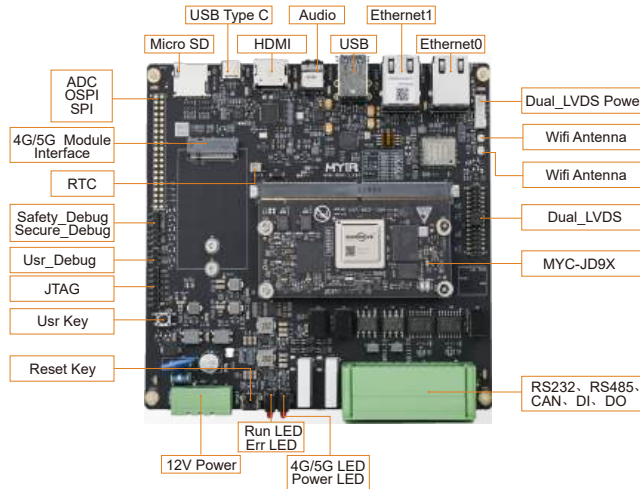
电力智能设备



工业机器人



轨道交通



开发板正面标注图



开发板背面标注图

MYC-JD9350核心板

- 基于国产芯驰D9-Plus处理器，内核5×Cortex-A55@1.6GHz+3×Cortex-R5@800MHz+0.8Tops NPU
- 安全加密：SIL4，ASILD级别功能安全独立域；硬件加密、国密认证、全场景ECC；支持100%国产物料定制
- 高可靠性：16nm车规级工艺，高性能、低功耗；高效以太网：2个千兆以太网接口，支持TSN双千兆
- MXM封装，314PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸82×45mm；系统Linux、Android、FreeRTOS、Ubuntu

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-JD9350-32E4D-160-I	D9-Plus	5×Cortex-A55@1.6GHz +3×Cortex-R5@800MHz +0.8Tops NPU	4GB LPDDR4	32GB eMMC	E2PROM	MXM 314PIN	-40°C~+85°C	82×45mm	Linux Android FreeRTOS Ubuntu	MYD-JD9350-32E4D-160-I

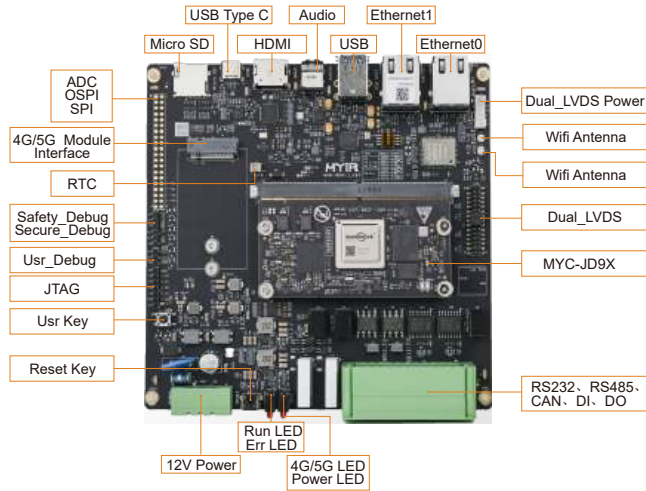


扫一扫了解更多参数

● 核心板扩展信号

通信接口	2×千兆以太网，支持TSN、2×USB3.0、2×PCIe3.0、16×UART、4×CAN FD、2×SDIO、8×SPI、12×I2C、8×PWM、4×ADC
多媒体接口	MIPI DSI、LVDS、MIPI CSI、Parallel CSI

● 应用场景



开发板正面标注图



开发板背面标注图

MYC-JD9360核心板

- 基于国产芯驰 D9-Pro高端处理器，内核6×Cortex-A55@1.6GHz+Cortex-R5@800MHz+0.8Tops NPU
- 低功耗：TSMC 车规工业16nm FinFET 先进工业保证相对较低的功耗；内置超大Cache，大带宽DDR4 2400MT/S
- 多屏异显：支持双屏异显2x1080p，支持R5控制第三屏HMI；高清图像VPU：H.264编解码4Kp30，H.265解码4Kp30
- MXM封装，314PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸82×45mm；系统Linux、Android、FreeRTOS、Ubuntu



扫一扫了解更多参数

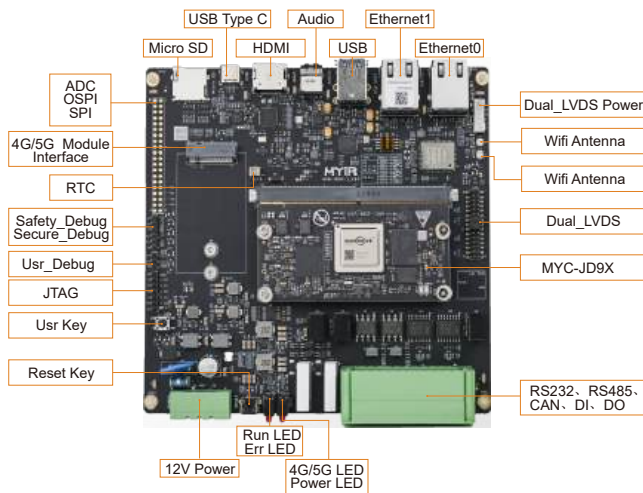
产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-JD9360-16E2D-160-I	D9-Pro	6×Cortex-A55@1.6GHz +Cortex-R5@800MHz +0.8Tops NPU	2GB LPDDR4	16GB eMMC	E2PROM	MXM 314PIN	-40°C~+85°C	82×45mm	Linux Android FreeRTOS Ubuntu	MYD-JD9360-16E2D-160-I

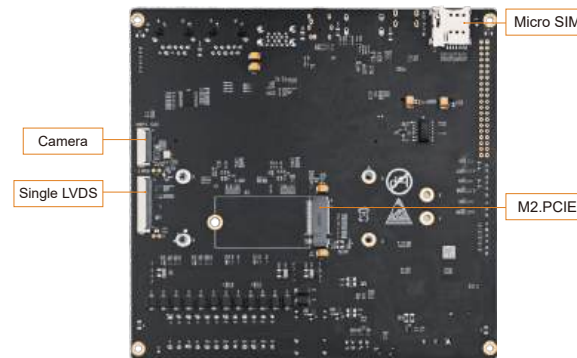
核心板扩展信号

通信接口	2×千兆以太网，支持TSN、2×USB3.0、2×PCIe3.0、16×UART、4×CAN FD、2×SDIO、8×SPI、12×I2C、8×PWM、4×ADC
多媒体接口	MIPI DSI、LVDS、MIPI CSI、Parallel CSI

应用场景



开发板正面标注图

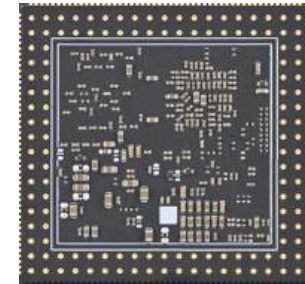


开发板背面标注图



MYC-YD9360核心板

- 基于国产芯驰D9-PRO处理器，集成了6×Cortex-A55@1.6GHz+Cortex-R5@800MHz+0.8Tops NPU
- 高性能的高安全HSM安全的处理器，支持TRNG、AES、RSA、SHA、SM2/3/4/9
- 集成 PCIe3.0, USB3.0, 2x千兆TSN以太网, 4xCAN-FD, 16xUART, SPI 等丰富的外设接口
- LCC+LGA封装, 324PIN; 工业级: -40°C~+85°C; 尺寸52×50mm; 系统Linux、Android、FreeRTOS、Ubuntu



扫一扫了解更多参数

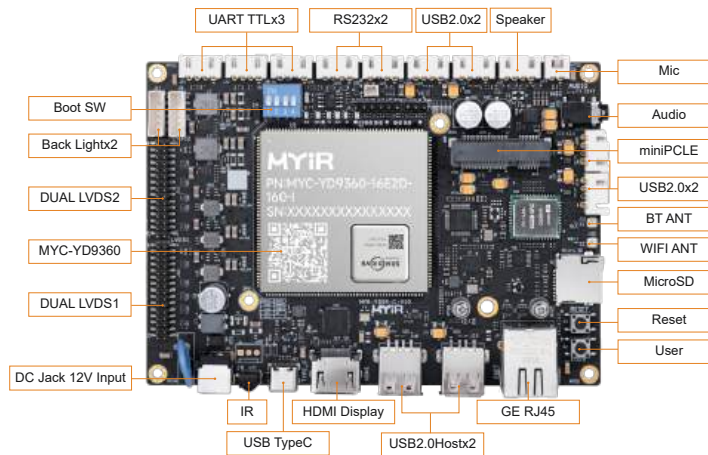
● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-YD9360-16E2D-160-I	D9-PRO	6×Cortex-A55@1.6GHz +Cortex-R5@800MHz +0.8Tops NPU	2GB LPDDR4	16GB eMMC	E2PROM	LCC+LGA 324PIN	-40°C~+85°C	52×50mm	Linux	MYD-YD9360-16E2D-160-I
MYC-YD9360-16E2D-160-C							0°C~+70°C		Android FreeRTOS Ubuntu	

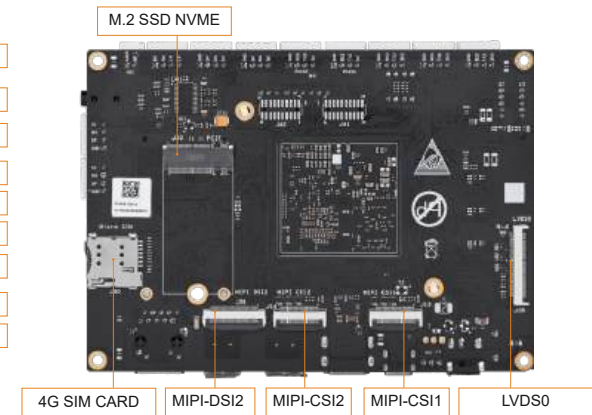
● 核心板扩展信号

通信接口	2×千兆以太网, 支持TSN、2×USB3.0、2×PCIe3.0、16×UART、4×CAN FD、2×SDIO、8×SPI、12×I2C、8×PWM、4×ADC
多媒体接口	2×MIPI DSI、LVDS、MIPI CSI、Parallel CSI

● 应用场景



开发板正面标注图



开发板背面标注图

Rackchip | MYC-YR3562核心板

- 基于瑞芯微RK3562处理器，4×Cortex-A53@2.0GHz+MCU@200MHz
- GPU G52, VPU 4K@30fps解码, 1080p@60fps 编码, NPU 1Tops (RK3562)
- 接口丰富: RGMII+RMII、PCIE/USB3.0、原生2路CAN (RK3562J) 接口、10路UART接口等
- LCC+LGA, 222pin封装; 商业级: 0°C~+70°C, 工业级: -40°C~+85°C; 尺寸43×45mm; 系统Linux、Debian



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-YR3562J-16E2D-180-I-G	RK3562J	4×Cortex-A53@1.8GHz+MCU@200MHz, 2×CAN	2GB LPDDR4	16GB eMMC	32KBit EEPROM	LCC 164pin + LGA 58pin	-40°C~+85°C	43×45mm	Linux Debian	MYD-YR3562J-16E2D-180-I-GK
MYC-YR3562J-8E1D-180-I-G			1GB LPDDR4	8GB eMMC						-
MYC-YR3562-16E2D-200-C	RK3562	4×Cortex-A53@2.0GHz+MCU@200MHz, 1Tops NPU	2GB LPDDR4	16GB eMMC			0°C~+70°C			MYD-YR3562-16E2D-200-C

● 核心板扩展信号

通信接口	RGMII+RMII、SDIO、USB3.0/PCIE2.1、USB2.0、10×UART、2×CAN (RK3562J)
多媒体接口	LVDS、MIPI DSI、Parallel DSI、3×I2S
其他接口	6×I2C、16×PWM、3×SPI、26×10bit SARADC

● 应用场景



工业网关



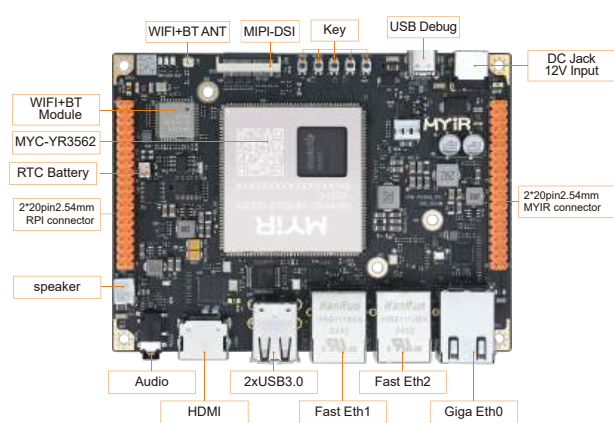
汽车电子



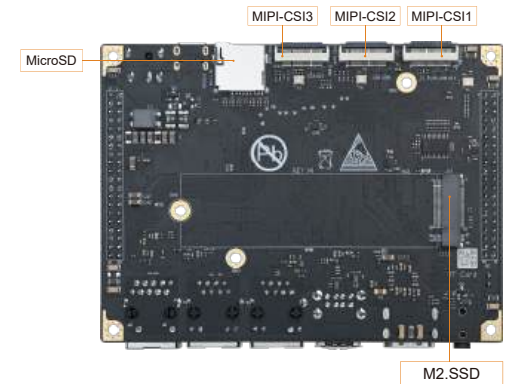
工业制造



智能电力



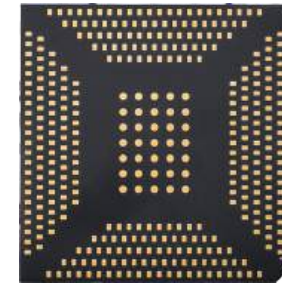
开发板正面标注图



开发板背面标注图

Rockchip | MYC-LR3568核心板

- 基于瑞芯微RK3568处理器，4×Cortex-A55@1.8GHz
- 支持4K高清解码，三屏异显，1 Tops AI加速
- 接口丰富：HDMI、2×GE、PCIE、SATA、10×UART、3×CAN等
- LGA 381PIN；宽温级和工业级可选；尺寸43×45mm；系统Linux、Debian、OpenHarmony



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-LR3568J-32E4D-180-I	RK3568J	4×Cortex-A55@1.8GHz 1 Tops NPU	4GB LPDDR4X	32GB eMMC	-	LGA 381PIN	-40°C~+85°C	43×45mm	Linux Debian OpenHarmony	MYD-LR3568J-32E4D-180-I-GK
MYC-LR3568J-16E2D-180-I			2GB LPDDR4X	16GB eMMC						MYD-LR3568J-16E2D-180-I-GK
MYC-LR3568J-8E1D-180-I			1GB LPDDR4	8GB eMMC						-
MYC-LR3568B2-32E4D-200-E	RK3568B2	4×Cortex-A55@2.0GHz 1 Tops NPU	4GB LPDDR4X	32GB eMMC	-	LGA 381PIN	-20°C~+70°C	43×45mm	Linux Debian OpenHarmony	MYC-LR3568B2-32E4D-200-E
MYC-LR3568B2-16E2D-200-E			2GB LPDDR4X	16GB eMMC						MYD-LR3568B2-16E2D-200-E

● 核心板扩展信号

通信接口	2×千兆以太网、2×USB2.0、2×USB3.0、2×PCIe3.0、PCIe2.1、SDIO SATA3.0、10×UART、3×CAN、4×SPI、6×I2C、16×PWM、8×ADC
多媒体接口	HDMI2.0a、eDP1.3、Dual MIPI-DSI_TX、Single LVDS、Parallel DSI 2×MIPI CSI、Parallel CSI、4×I2S/TDM、8×ADC

● 应用场景



工业HMI



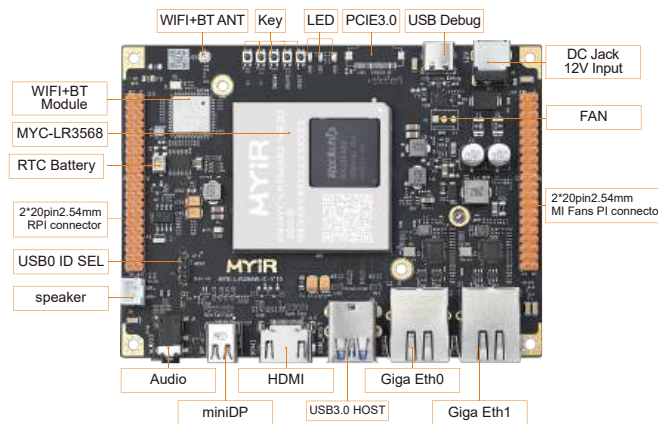
充电桩



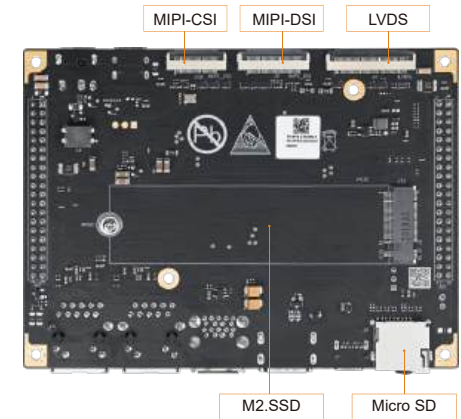
工业制造



电力系列



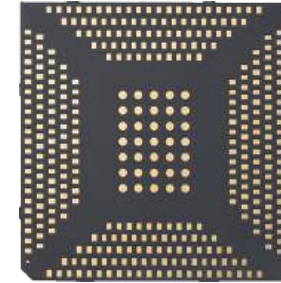
开发板正面标注图



开发板背面标注图

Rackchip | MYC-LR3576核心板

- 基于RK3576处理器，内核4×Cortex-A72@2.2GHz+4×Cortex-A53@1.8GHz+Cortex-M0@400MHz
- 6TOPS NPV，赋能边缘计算应用场景
- 支持三屏异显，丰富的多媒体接口HDMI、DVP、MIPI-DSI、MIPI-CSI
- LGA封装，381PIN；商业级：0°C~+70°C；尺寸：43×45mm



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-LR3576-32E4D-220-C	RK3576	4×Cortex-A72@2.2GHz+ 4×Cortex-A53@1.8GHz+ Cortex-M0@400MHz 6TOPS NPV	4GB LPDDR4X	32GB eMMC	32KBit EEPROM	LGA 381PIN	0°C~+70°C	43×45 mm	Linux Debian	MYD-LR3576-32E4D-220-C
MYC-LR3576-64E8D-220-C			8GB LPDDR4X	64GB eMMC						MYD-LR3576-64E8D-220-C

● 核心板扩展信号

通信接口	2×千兆以太网、USB/DP combo、PCIe2.1、SDIO、SATA3.0、12×UART、2×CAN FD、5×SPI、10×I2C、10×I3C、DSMC/FlexBus
多媒体接口	2×MIPI-CSI、DVP、HDMI、MIPI-DSI、2×SPDIF TX、2×SPDIF RX、5×I2S
其他接口	8×SARADC

● 应用场景



智能医疗



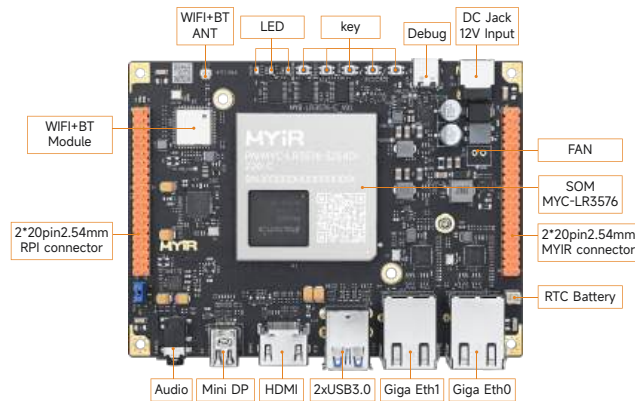
汽车电子



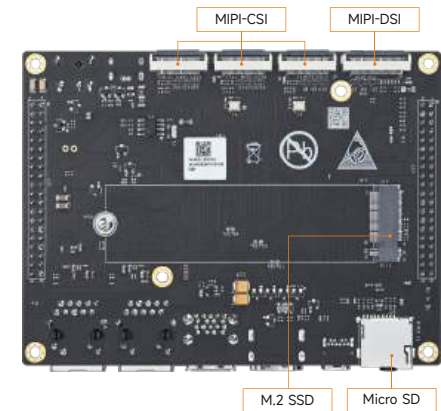
工业制造



智能电力



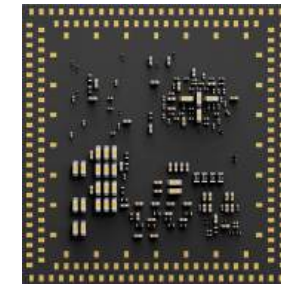
开发板正面标注图



开发板背面标注图

HISILICON | MYC-LHI3093核心板

- 基于国产海思Hi3093处理器，4×Cortex-A55@1.0GHz， 实时M3@200MHz， 安全M3@400MHz
- 硬件AMP， 2*A55应用系统+2*A55硬实时系统+M3安全系统， 高性能安全可信模组新标杆
- 接口丰富：2×GE、2×FE、3×USB、2×PCIE、LocalBus、VGA、2×CAN、8×Uart、16×I2C、12×PWM等
- LGA封装， 220PIN； 宽温级：-20°C~+70°C； 尺寸43×45mm； 系统openEuler-22.03、libck、FreeRTOS



扫一扫了解更多参数

产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-LHI3093-16E2D-100-E	海思Hi3093	4×Cortex-A55@1.0GHz +2×M3	2GB DDR4	16GB eMMC	-	LGA 220PIN	-20°C~+70°C	43×45mm	openEuler	MYD-LHI3093-16E2D-100-E

核心板扩展信号

通信接口	2×千兆以太网、2×百兆以太网、3×USB2.0、USB3.0、2×PCIe2.0、8×UART、SDIO2.0、2×SPI、2×CAN、16×I2C、12×PWM、16×ADC
多媒体接口	VGA

应用场景



工业HMI



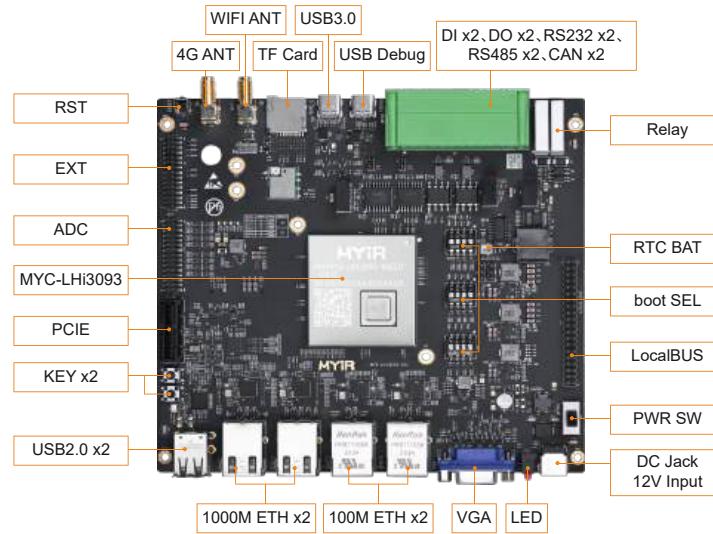
电力智能设备



工业机器人



轨道交通



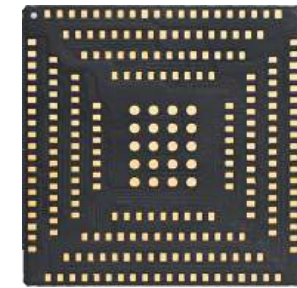
开发板正面标注图



开发板背面标注图

nuvoTon | MYC-LMA35核心板

- 基于新唐MA35D1处理器，2xCortex-A35@800MHz+Cortex-M4@180MHz
- 17路UART和4路CAN FD，提供灵活的数据传输能力
- 集成了2D图形加速器、LCD 控制器、JPEG 和 H.264 解码器
- 具备硬件加速的AES加密引擎和真随机数发生器，支持安全启动和数据加密
- LGA封装，252PIN；工业级：-40°C~+85°C；尺寸37×39mm；系统Linux, Debian, OpenWrt



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-LMA35-256N256D-80-I	MA35D16A887C	2xCortex-A35@800MHz +Cortex-M4@180MHz	芯片内置 256MB DDR3L	256MB SPI NAND	32KBit EEPROM	LGA 252PIN	-40°C~+85°C	37×39mm	Linux Debian OpenWrt	MYD-LMA35-256N256D-80-I
MYC-LMA35-8E256D-80-I				8GB eMMC						MYD-LMA35-8E256D-80-I
MYC-LMA35-8E512D-80-I	MA35D16AJ87C	芯片内置 512MB DDR3L		MYD-LMA35-8E512D-80-I						

● 核心板扩展信号

通信接口	2×RGMII、2×USB 2.0、4×CAN FD、17×UART、4×SPI、6×I2C、SDIO 3.0
多媒体接口	1×RGB、2×Parallel CSI、2×I2S
其他接口	8×EADC、1×JTAG、18×EPWM

● 应用场景



工业网关



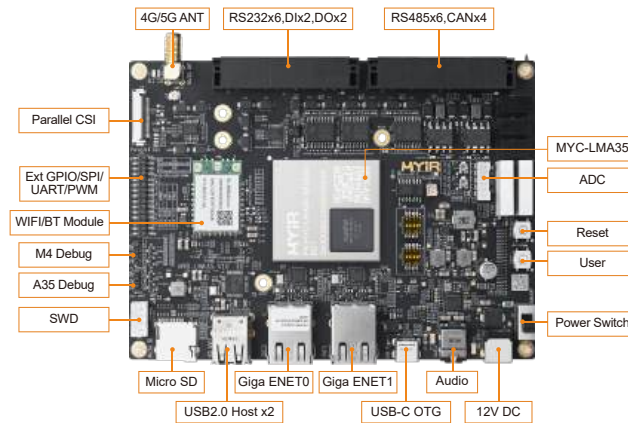
充电桩



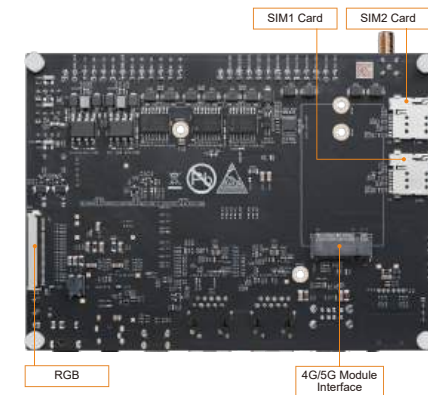
工业制造



电力DTU



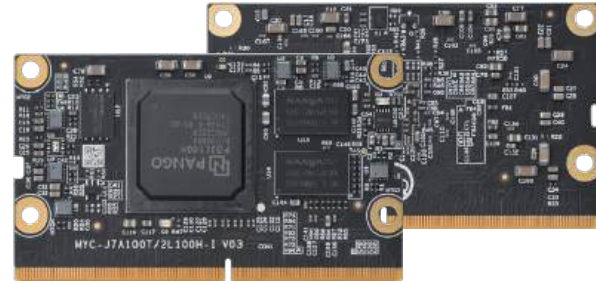
开发板正面标注图



开发板背面标注图

紫光同创 | MYC-J2L100H核心板

- 采用国产紫光同创Logos 系列处理器，可编程逻辑：66600 LUT6s, 133K DFF, 5.5Mb Bram, 240 APM 25X 18
- 可编程IO：支持LVCMOS1.5V-3.3V, LVDS_18, LVDS_25; 285x IOs
- 高速接口：4路6.6Gb/s HSST, 1路PCIE GEN2 X 4
- MXM封装, 260PIN; 工业级: -40°C-85°C; 尺寸69.6×40mm



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-J2L100H-32Q512D-I	PG2L100H-6IFBG484	-	512MB DDR3	32MB QSPI	32KB EEPROM	MXM 260PIN	-40°C-85°C	69.6×40mm	-	MYD-J2L100H-32Q512D-I

● 核心板外投资源

项目	IO数量	描述
Bank 13	35	分bank引出178 HRIO
Bank14	45	
Bank15	48	
Bank16	50	
MGTP	4 pair	6.6Gb/s 串行收发器
JTAG	4	JTAG 调试

● 应用场景



通信设备



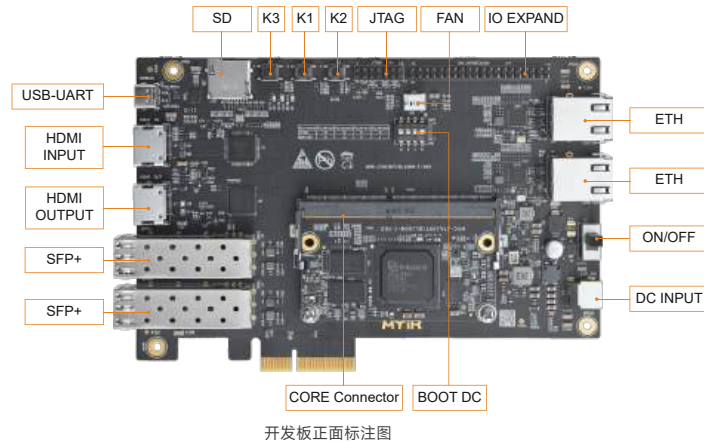
图像处理



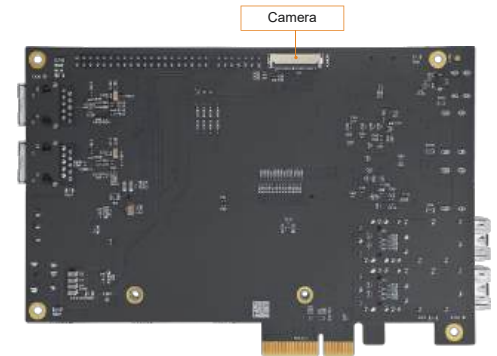
工业控制



医疗设备



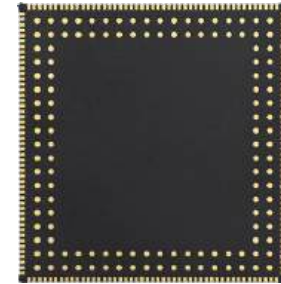
开发板正面标注图



开发板背面标注图

安路科技 | MYC-YM90X核心板

- 采用国产安路SALDRAGON 1系列处理器，内核2×Cortex-A35@800MHz，集成0.4 TOPS NPU，支持JPEG压缩解压
- 可编程逻辑：52480 LUT6s，10K DFF，5.4Mb Bram，240 DSP48
- 可编程IO：支持LVCMOS1.5V-3.3V I/O LVDS_18 LVDS_25；200×IOs
- 2×CAN-FD，2×UART，2×SPI，2×I2C，2×三速以太网，2×USB2.0，2×SD / SDIO / eMMC5.1控制器
- LCC+LGA封装，201PIN；工业级：-40°C-85°C；尺寸52×50mm；系统Linux



扫一扫了解更多参数

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

核心板型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	MIPI	封装	工作温度	尺寸	软件	对应开发板型号
MYC-YM90G-8E1D-80-I	DR1M90GEG484	2×Cortex-A35@800MHz	1GB DDR3	8GB eMMC	32MB QSPI Flash	YES	LCC+LGA 201PIN	-40°C-85°C	52×50mm	Linux	MYD-YM90G-8E1D-80-I
MYC-YM90M-8E1D-80-I	DR1M90MEG484					NO					MYD-YM90M-8E1D-80-I

● 核心板扩展信号

PL资源	可编程逻辑：52480 LUT6s，10K DFF，5.4Mb Bram，240 DSP48 可编程IO：支持LVCMOS1.5V-3.3V I/O LVDS_18 LVDS_25；200x IOs
PS性能	2×Cortex-A35@800MHz；集成0.4 TOPS NPU；完整端侧AI部署工具链； 集成JPU：支持JPEG 压缩解压缩；2×CAN-FD，2×UART，2×SPI，2×I2C， 2×三速以太网，2×USB2.0，2×SD / SDIO / eMMC5.1控制器

● 应用场景



机器视觉



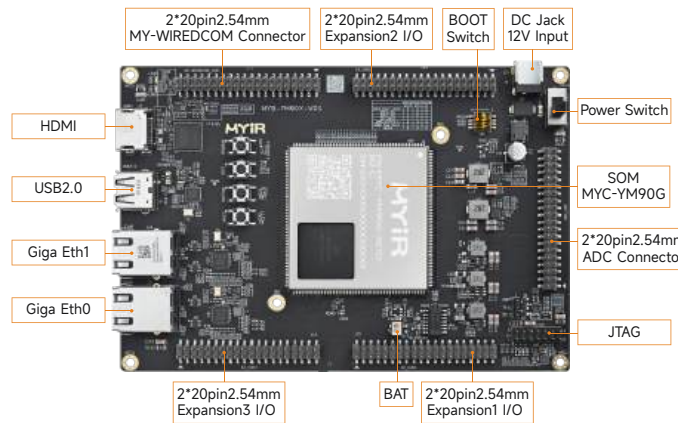
能源电力



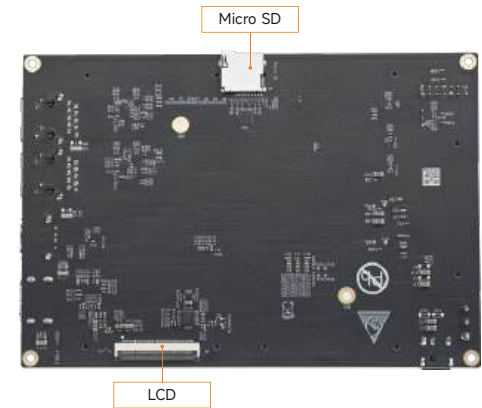
工业控制



汽车电子



开发板正面标注图



开发板背面标注图

应用与方案

嵌入式工业单板机

嵌入式工业单板机是集成了处理器、内存、存储以及各种外设接口的完整计算系统，经过严格的设计和测试，具有较高的稳定性和可靠性，能够长时间稳定运行在恶劣的工业环境中，工程师和开发人员可以直接在上面进行应用开发和部署，广泛应用于工业控制、工业自动化、工业数据采集、医疗器械等领域。

- ▶ 米粉派T527
- ▶ 米粉派RK3568
- ▶ Remi Pi / 瑞米派
- ▶ MYD-LT527-SX商显板
- ▶ MYD-YD9360商显板
- ▶ MYS-8MMX-V2
- ▶ 百度/米尔 FZ3深度学习计算卡
- ▶ Z-turn Board-V2
- ▶ Z-turn Lite Board

嵌入式工控一体机

嵌入式工控一体机是专门为工业控制应用而设计的嵌入式计算机，采用一体化设计，将单板机、通信模块、组件和外壳整合在一个设备中，整机拥有抗干扰、耐高低温、防尘防水、长时间稳定运行等特点，广泛应用在工业自动化、仪表测试、数据采集、物联网、智能交通、能源管理、医疗器械、轨道交通等领域。

- ▶ MYD-LT527微型工控机
- ▶ MYD-LR3568微型工控机
- ▶ MYD-LR3576-B边缘计算盒
- ▶ MYD-JD9340工控机
- ▶ MY-EVC700S-V2嵌入式控制单元

ALLWINNER | 米粉派T527



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

米粉派 T527 是以全志 T527 处理器为核心的单板电脑 (SBC), 具备八核 A55@1.8GHz, G57 GPU、8K 编解码 VPU, 4GB LPDDR4+32GB eMMC, 100% 国产化物料核心板。具备 HDMI+DP+MIPI-DSI+LVDS 四路显示接口, 支持 4K+1080p 双高清异显, 支持两路 MIPI-CSI 800W 摄像接口, 3.5mm 音频插座, 支持双千兆网口、双频 WIFI+BT5.2、USB3.0+2*USB2.0 扩展、2*CAN2.0、4*IIC、2*SPI、9*UART、3*PWM、2*ADC 等。通过兼容树莓派接口 40pin 插针引出, 另外还有米粉派 T527 自定义 40pin 插座扩展。



正面



背面

● 应用场景



边缘计算



电力测控终端



机器人控制盒



工控机

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

产品型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	工作温度	尺寸	软件
MYD-LT527M-16E2D-180-E	全志T527M	4×Cortex-A55@1.8GHz +4×Cortex-A55@1.4GHz, RISC-V 200MHz	2GB LPDDR4	16GB eMMC	-20°C~+70°C	120×90mm	Android Linux Ubuntu

● 产品参数

	功能	参数
系统	POWER	12V DC
	KEY	1路复位按键、1路 wakeup、1路用户按键
	SD	1路 Micro SD 卡槽
	DEBUG	2路 TTL 调试串口, 从 RPI Interface 引脚引出
	风扇接口	1路风扇插座, 带 PWM 调速
通讯接口	Ethernet	2路 10/100/1000M 以太网 RJ45 接口
	WIFI/BT	板载 WIFI 模块, 支持 802.11a/b/g/n/AC+BT 5.2
	USB	1路 USB3.0 +1路 USB2.0, 采用 1x2 Type-A 接口 1路 USB2.0, 40pin 插针内
	CAN	2路 CAN 接口, 通过扩展接口引出
多媒体接口	DISPLAY	1路 HDMI 接口, HDMI A-type 插座
		1路 DP 接口, miniDP 插座
		1路 MIPI-DSI, FPC 插座
		1路 single LVDS, FPC 插座
VIDEO INPUT	2路 4 lane MIPI-CSI	
AUDIO	1路音频接口, 3.5mm 耳麦插座	
扩展接口	RPI Interface	2.54mm 间距的 40PIN 排针, GPIO/I2C/UART/SPI/CAN
	MI Fans PI 接口	2.54mm 间距的 40PIN 排针, GPIO/I2C/UART/SPI/USB/PWM

Rockchip | 米粉派RK3568



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

MYB-LR3568 是与 MYC-LR3568 核心板配套使用的扩展底板，采用 12V/3A 直流供电，搭载了 两路千兆以太网接口、板载 WIFI+BT 模块、HDMI+miniDP+MIPIDSI+LVDS 四种显示接口、1 路 3.5mm 音频接口、1 路 USB3.0 HOST、1 路 USB3.0 OTG 接口、1 路 Micro SD 接口、1 路兼容树莓派 40pin 扩展接口、1 路米尔自定义 40pin 扩展接口。



正面



背面

● 应用场景



工业HMI



充电桩



工业制造



电力系列

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

● 产品参数

功能		参数
系统	POWER	12V DC
	KEY	RST、UPLOAD、PWR、V+、V-
	SD	1路 Micro SD 卡槽
	SSD	M.2 NVME SSD 盘插座,尺寸 2280,PCIe 信号
	DEBUG	USB TYPE-C,内置 USB 转 TTL DEBUG
	风扇接口	1路风扇插座,带 PWM 调速
通讯接口	Ethernet	2路 10/100/1000M 以太网 RJ45 接口
	WIFI/BT	板载 WIFI 模块,支持 802.11a/b/g/n/AC+BT 5.2
	USB	2路 USB3.0,采用 1x2 Type-A 接口
		1路 USB2.0,40pin 插针内
CAN	2路 CAN 接口,通过扩展接口引出	
多媒体接口	DISPLAY	1路 HDMI 接口 ,HDMI A-type 插座
		1路 DP 接口 ,miniDP 插座
		1路 MIPI-DSI,FPC 插座
		1路 single LVDS,FPC 插座
	VIDEO INPUT	1路 4 lane MIPI-CSI
AUDIO	1路音频接口,3.5mm 耳麦插座	
扩展接口	RPI Interface	2.54mm 间距的 40PIN 排针,GPIO/I2C/UART/SPI/CAN
	MiFAN Interface	2.54mm 间距的 40PIN 排针,GPIO/I2C/UART/SPI/USB/PWM

产品型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	工作温度	尺寸	软件
MYD-LR3568B2-16E2D-200-E	RK3568B2	4×ARM Cortex-A55 @2.0GHz	2GB LPDDR4	16GB eMMC	-20°C~+70°C	120×90mm	Linux Debian OpenHarmony

RENESAS | Remi Pi / 瑞米派



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

Remi Pi 是一款以瑞萨 RZ/G2L 处理器, Cortex-A55 内核为核心的嵌入式板卡, 主频为 1.2GHz。配备了 1GB 高速 DDR4 和 8GB eMMC, 集成了双路千兆以太网、双频 2.4GHz/5GHz WIFI+BT4.2 模块、USB 2.0 HOST、USB 2.0 OTG、HDMI 显示接口、LVDS 显示接口、MIPI CSI 摄像头接口、音频输入输出接口以及兼容树莓派的 40PIN 接口。



Remi Pi 正面



Remi Pi 背面

● 应用场景



工业HMI



医疗器械



工业自动化



商业显示

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

产品型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	工作温度	尺寸	软件
MYD-YG2L23-8E1D-120-C-REMI	R9A07G044L23GBG	2×Cortex-A55@1.2GHz+ Cortex-M33@200MHz	1GB DDR4	8GB eMMC	0°C~+70°C	120×70mm	Linux Ubuntu Debian

● 产品参数

功能	参数
处理器	瑞萨 RZ/G2L(2×Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz)
内存	1GB DDR4
存储器	8GB eMMC
电源	PMIC, RAA215300
供电	USB Type-C 供电接口
WIFI/BT	2.4GHz/5GHz WIFI+BT4.2 模块
Ethernet	2 路千兆以太网接口
USB	1 路 USB 2.0 OTG Type-C 接口
	2 路 USB 2.0 HOST Type-A 接口
Multimedia	1 路 HDMI 显示接口
	1 路 LVDS 显示接口
	1 路 MIPI CSI 摄像头接口
	1 路音频输入输出接口
Debug	2 路 UART debug (Cortex-A55, Cortex-M33)
Buttons	ON/OFF, RESET, USER
Status LED	Power, system status
RPI Interface	1 路兼容树莓派的 40PIN Header, GPIO/I2C/UART/SPI/CAN
RTC	Used for timing when power off



扫一扫了解更多参数

产品介绍

MYD-YD9360 商显板基于芯驰 D9360 处理器为核心的高清多屏商显主板，具备六核 A55@1.6GHz, 100GFLOPS GPU、4K 编解码 VPU、0.8Tops AI NPU 的核心，硬件存储 ECC、ASIL B 功能安全，2GB LPDDR4+16GB eMMC，100% 国产化物料核心板。具备 HDMI+2*LVDS+MIPI DSI 四路显示接口，支持三屏异显，支持两路 MIPI-CSI 摄像接口，3.5mm 音频插座，支持千兆网口、WIFI+BT、7*USB 扩展、2*IIC、5*UART 等。



MYD-YD9360 商显板正面



MYD-YD9360 商显板背面

应用场景



机械工程智能盒



智能医疗器械



工业机器人



智能座舱

产品选型 (其他配置可批量定制)

产品型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	工作温度	尺寸	软件
MYD- YD9360-16E2D-160-C	芯驰D9-Pro (D9360)	6×Cortex-A55@1.6GHz + Cortex-R5@800MHz	2GB LPDDR4	16GB eMMC	-20°C~+70°C	140×100mm	Android Linux Ubuntu

产品参数

	功能	参数	
系统	POWER	12V 2A, DC-Jack 插座	
	KEY	1 路复位按键、1 路用户按键	
	BOOT SET	1 路拨码开关	
	SD	1 路 Micro SD 卡槽, 可以接入 128G TF 卡;	
	SSD 固态硬盘槽位	M.2 B 插座, 4 lane PCIE 信号, 可接入 NVME 固态硬盘;	
	LED	1 路 5G/4G 状态指示灯, 1 路系统运行指示灯 2 路电源指示, 1 路用户自定义灯 (默认报错指示灯)	
DEBUG		1 路 Safety 域调试串口, 1 路 AP 域调试串口	
		1 路 Secure 调试串口	
通讯接口	WIFI/BT	板载 WIFI/BT 模块	
	5G/4G	1 路 MINI PCIE 型插座 5G/4G 模块接口, 1 路 SIM 卡座	
	Ethernet	1 路 10/100/1000M 以太网接口, RJ45 接口, 支持 TSN	
	USB		2 路 USB 2.0 HOST 接口, 采用 Type-A 接口
			4 路 USB 2.0 HOST 接口, 采用 4PIN 座子引出
			1 路 USB 2.0 软件烧写接口, 采用 Type-C 接口
	UART	3 路 UART 接口, 通过 4PIN 座子引出; 2 路 RS232 接口, 通过 4PIN 座子引出	
IR	1 路红外输入		
多媒体接口	DISPLAY	2 路双通道 LVDS 显示接口	
		1 路 HDMI 接口 +1 路 LVDS, 由 MIPI-DSI 转换而来	
		1 路 MIPI DSI 接口, 通过 30PIN 的 FPC 座子引出	
	CAMERA	2 路 MIPI CSI 摄像头接口	
AUDIO	1 路双声道音频输出接口, 2 路单通道音频输入接口, 1 路双声道的功放接口		
扩展接口	Expansion IO	2 路扩展接口, 用作预留	

ALLWINER | MYD-LT527-SX商显板



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

MYB-LT527-SX 是与 MYC-LT527 核心板配套使用的扩展底板，采用 12V 直流供电，搭载了 2 路千兆以太网接口、1 路 miniPCIE 型插座的 5G/4G 模块接口、板载 WIFI/ 蓝牙模块、1 路 HDMI 显示、1 路双 LVDS 显示、1 路 eDP 显示、1 路 MIPI-DSI 显示、2 路 MIPI-CSI 摄像、1 路 3.5mm 耳麦接口、1 路内置 mic、2 路扬声器、2 路 USB Type A、4 路 4PIN 座子 USB HOST 接口、1 路 MicroSD、2 路 RS232 接口、1 路 RS485、2 路 TTL UART 接口、2 路 CAN 及其他扩展接口。



正面



背面

● 应用场景



车载显控



商业显示



高性能机器人



工业HMI

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

产品型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	工作温度	尺寸	软件
MYD-LT527M-16E2D-180-E-SX	全志T527M	4×Cortex-A55@1.8GHz +4×Cortex-A55@1.4GHz, RISC-V 200MHz	2GB LPDDR4	16GB eMMC	-20°C~+70°C	140×100mm	Android Linux Ubuntu

● 产品参数

	功能	参数	
系统	POWER	12V 2A, 5.5-2.1 带锁 DC 座	
	KEY	1 路复位按键、1 路用户按键	
	TF Card	1 路 TF 卡槽, 可以接入 128G TF 卡;	
	LED	1 路电源指示, 1 路用户自定义灯 (默认报错指示灯)	
	DEBUG	1 路 TTL 调试串口	
通讯接口	WIFI/BT	板载 WIFI/BT 模块	
	5G/4G	1 路 MINI PCIE 型插座 5G/4G 模块接口, 1 路 SIM 卡座	
	Ethernet	1 路 10/100/1000M 以太网接口, RJ45 接口, 支持 TSN	
	USB		1 路 USB 2.0 OTG 接口, 采用 Type-A 接口
			1 路 USB 3.0 HOST 接口, 采用 Type-A 接口
			4 路 USB 2.0 HOST 接口, 采用 4PIN 座子引出
	UART		1 路 RS485 接口, 通过 4PIN 座子引出;
		2 路 RS232 接口, 通过 4PIN 座子引出;	
		2 路 TTL UART 接口, 通过 4PIN 座子引出;	
IR		1 路红外输入	
多媒体接口	DISPLAY	HDMI、LVDS、eDP、MIPI DSI 接口各 1 路, 2 路背光、1 路 I2C 触摸接口	
	CAMERA	2 路 MIPI CSI 摄像头接口	
	AUDIO	1 路 3.5mm 耳麦接口, 1 路 mic 输入接口, 1 路双声道的扬声器接口	
扩展接口	Expansion IO	2 路扩展接口, 用作预留	

NXP | MYS-8MMX-V2



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

MYS-8MMX-V2 单板, 基于 i.MX8MMini 处理器, 将良好的处理能力与先进的音频、视频和图形功能集于一身, 提供低功耗、高性能的解决方案, 采用先进的 14LPC FinFET 工艺技术构建, 提供更快的速度和更高的电源效率。凭借商业和工业级认证以及恩智浦产品长期供货计划的支持, i.MX 8M Mini 家族可用于任何通用工业和物联网应用。



MYS-8MMX-V2 带外壳



MYS-8MMX-V2 单板正面

● 应用场景



智慧消防



医疗器械



能源电力



工业控制

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

产品型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	工作温度	尺寸	软件	有无外壳
MYS-8MMQ6-V2-8E2D-180-C	MIMX8MM6DVTLZAA	4×Cortex-A53@1.8GHz+ Cortex-M4@400MHz	2GB DDR4	8GB eMMC	0°C~+70°C	95×69mm	Linux Ubuntu	无外壳
MYS-8MMQ6-V2-8E2D-180-C-B						135×74.5×35.8mm		有外壳
MYS-8MMQ6-V2-8E2D-160-I	MIMX8MM6CVTKZAA	4×Cortex-A53@1.6GHz+ Cortex-M4@400MHz			-40°C~+85°C	95×69mm		无外壳
MYS-8MMQ6-V2-8E2D-160-I-B						135×74.5×35.8mm		有外壳

● 产品参数

功能	参数
CPU 型号	MIMX8MM6DVTLZAA 高达 1.8GHz
DDR	2GB DDR4
eMMC	8GB eMMC
电源输入	x1 凤凰端子 (2 PIN)
USB	x1 Type-C USB
	X2 USB 2.0 HOST Type A
显示触摸	x1 单路 LVDS, 40pin FPC 接口, 支持触摸电容屏
	x1 HDMI 输出
网络	X1 千兆以太网 RJ45
SMA	x1 WIFI/BT 天线 SMA
RTC 电池座	x1 1.25MM 间距 2PIN 座子
M.2 座子	x1 SSD 卡 2242
摄像头	x1 MIPI 接口数字摄像头信号, 24pin FPC
扩展排针	x1 2x25_2.0mm 间距双排针
Micro SD	x1 Micro SD 插槽 用于 Miro SD 卡启动
按键	x1 Reset 复位按键
	x1 ONOFF 开关机按键
	x1 用户自定义按键
调试串口	x1 3 Pin 2.54mm 间距



扫一扫了解更多参数

AMD | 百度/米尔 FZ3深度学习计算卡

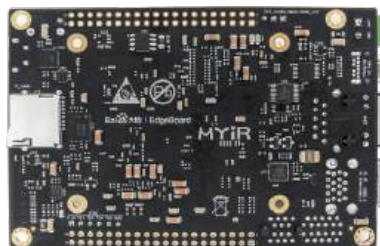
● 产品介绍

采用了 AMD 最新的基于 16nm 工艺的 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC 平台，集成了四核 Cortex-A53 处理器，双核 Cortex-R5 实时处理单元以及 Mali-400 MP2 图形处理单元及 16nm FinFET+ 可编程逻辑相结合的异构处理系统，具有高性能，低功耗，高扩展等特性，能在工业设计中满足各种需要。

● 产品参数



正面



背面

功能	参数
CPU	XCZU3EG
DDR	2GB DDR4 64bit (512MB*4); 4GB 可选
eMMC	8GB eMMC
QSPI FLASH	32MB QSPI
EEPROM	32KB I2C eeprom
PHY	Gigabit PHY * 1
	USB 2.0 PHY * 1
Mini DP	4K/30fps (2lane)
Ethernet	1000Mbps
USB3.0	5Gbps
USB2.0	2 in USB3.0 CON, 2 in Expansion IO
PCIe	PCIe 2.1 x 1 lane
MIPI	FPC_25PIN 4lane
BT1120	FPC_32PIN 16bit

● 应用场景



安防监控



医疗器械



工业质检



人工智能

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

产品型号		内核+主频	RAM	ROM	工作温度	其他存储	软件
MYS-ZU3EG-8E2D-EDGE (裸卡)	XCZU3EG-1SFVC7841	ARM:4×A53@1200MHz+ 2×R5@533MHz+ UltraScale+ FPGA 154K	2GB DDR4	8GB eMMC	-40°C~+85°C	32MB QSPI FLASH 32KB EEPROM	Linux 5.4.0 百度Paddle框架
MYS-ZU3EG-8E2D-EDGE-K2 (裸卡+配件包)			4GB DDR4				
MYS-ZU3EG-8E4D-EDGE (裸卡)							
MYS-ZU3EG-8E4D-EDGE-K2 (裸卡+配件包)							

AMD | Z-turn Board V2



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

Z-turn Board 是一款基于 Xilinx Zynq-7000 系列 SoC 芯片的 FPGA+ARM 的嵌入式单板，该产品降低了 SoC 系统的开发门槛，主要满足于工业控制、医疗、汽车、监控等领域。



正面



背面

● 应用场景



汽车行业



医疗器械



工业领域



视觉监控

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

产品型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	工作温度	尺寸	软件
MYS-7Z010-V2-0E1D-667-C (配套件)	XC7Z010-1CLG400	2×Cortex-A9@667Hz +Atrix 7 FPGA (28K)	1GB DDR3	1GB DDR3	16MB QSPI Flash	0°C~+70°C	63×102mm	Linux
MYS-7Z010-V2-0E1D-667-C-S (裸板)								
MYS-7Z020-V2-0E1D-766-C (配套件)	XC7Z020-2CLG400	2×Cortex-A9@766Hz +Atrix 7 FPGA (85K)						
MYS-7Z020-V2-0E1D-766-C-S (裸板)								

● 产品参数

功能	参数
CPU	Xilinx XC7Z010/XCZ7020, 最高支持 866MHz 主频
DDR	1GB DDR3 SDRAM
Flash	16MB QSPI Flash
传感器	三轴加速度计传感器, 温度传感器
USB	1 路 mini USB OTG 接口, 1 路 USB 调试串口
HDMI	1 路 HDMI 高清输出接口
TF 卡	1 路 TF 卡接口
CAN	1 路 CAN 接口
网口	1 路 10/100/1000Mbps 以太网接口
用户扩展接口	2 个 80PIN (共 160PIN) 双排接口, 间距 1.27mm PLIO: 90/106(XC7Z010/XC7Z020)
PCB 规格	8 层板设计, 沉金工艺, 独立的接地信号层, 无铅
机械尺寸	63mm x 102mm
软件支持	Linux 4.14.0 操作系统

AMD | Z-turn Lite



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

Z-turn Lite 是米尔推出的一款 Z-turn 精简版开发板。主板基于 ZYNQ-7000S 系列中的 XC7Z007S 单核 ARM+FPGA 的 SOC 为核心(可选 XC7Z010), 搭载开发必备的 10/100/1000M 网口、USB OTG、TF 卡、JTAG 接口, 其余接口通过扩展引出, 方便用户以最低成本实现芯片评估和产品开发。



正面



背面

● 应用场景



汽车行业



医疗器械



工业领域



视觉监控

● 产品选型(其他配置可批量定制)

产品型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	其他板载	工作温度	尺寸	软件
MYS-7Z010-L-C (配套件)	XC7Z010-1CLG400	2×Cortex-A9@667Hz +Atrix 7 FPGA (28K)	512MB DDR3	4GB eMMC	16MB QSPI Flash	0°C~+70°C	91×63mm	Linux
MYS-7Z010-L-C-S (裸板)	XC7Z010-1CLG400							

● 产品参数

功能	参数
CPU	Xilinx XC7Z010, ARM Cortex-A9 内核
	最高支持 866MHz 主频
DDR	512MB DDR3 SDRAM
Flash	4GB eMMC Flash, 16MB QSPI Flash
网口	1 路 10/100/1000Mbps 以太网接口
USB	1 路 mini USB OTG 接口
调试接口	1 个 14PIN 双排 JTAG 调试接口, 1 路 UART 调试串口
TF 卡	1 路 TF 卡接口
按键	1 个复位按键, 1 个用户按键
扩展接口	1 个 120PIN 双排接口
PCB 规格	10 层板设计, 沉金工艺, 独立的接地信号层, 无铅
机械尺寸	91mm x 63mm
软件支持	Linux 4.14.0 操作系统

ALLWINER | MYD-LT527微型工控机



扫一扫了解更多参数

产品介绍

MYD-LT527 微型工控机是以全志 T527 处理器为核心的 miniPC 产品，具备八核 A55@1.8GHz，G57 GPU、8K 编解码 VPU、2Tops AI NPU 的核心，4GB LPDDR4+32GB eMMC，100% 国产化物料核心板。具备 HDMI+miniDP 显示接口，支持 4K+1080p 双高清异显，支持两路 MIPI-CSI 800W 摄像接口，3.5mm 音频插座，支持双千兆网口、双频 WIFI+BT5.2、4G/5G 无线通讯、USB3.0+4*USB2.0 扩展等。通过兼容树莓派接口 40pin 插针引出，另外还有米粉派自定义 40pin 插座扩展。



MYD-LT527 微型工控机正面



MYD-LT527 微型工控机背面

应用场景



边缘计算机



电力智能设备



大算力控制器



综合网关

产品选型 (其他配置可批量定制)

产品型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	工作温度	尺寸	软件
MYD-LT527MN-32E4D-180-I-GK-B	全志T527MN	4×Cortex-A55@1.8GHz +4×Cortex-A55@1.4GHz, RISC-V 200MHz, 2Tops NPU	4GB LPDDR4	32GB eMMC	-40°C~+85°C	160×93.5×44mm	Android Linux Ubuntu
MYD-LT527M-16E2D-180-I-GK-B	全志T527M	4×Cortex-A55@1.8GHz +4×Cortex-A55@1.4GHz, RISC-V 200MHz	2GB LPDDR4	16GB eMMC			

产品参数

	功能	参数	
系统	POWER	12VDC 5.08 凤凰端子	
	KEY	1路 RST 复位按键、1路 USER 用户按键	
	SD	1路 Micro SD 卡槽	
通讯接口	Ethernet	2路 10/100/1000M 以太网 RJ45 接口	
	WIFI/BT	双频 WIFI 模块,支持 802.11a/b/g/n/AC+BT 5.2	
	4G/5G	板载 miniPCIe 插槽, SIM 卡插槽, 可支持 4G/5G 模块	
	USB		1路 USB2.0, 在 1x2 Type-A 接口上部
			1路 USB3.0, 在 1x2 Type-A 接口下部
			3路 USB2.0, Type-A 接口
UART	2路 RS485 接口, 1路 RS232 接口		
CAN	2路 CAN 接口		
多媒体接口	DISPLAY	1路 HDMI 接口, HDMI A-type 插座	
		1路 DP 接口, miniDP 插座	
	AUDIO	1路音频接口, 3.5mm 耳麦插座	

Rockchip | MYD-LR3568 微型工控机



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

MYD-LR3568 微型工控机是以瑞芯微 RK3568 为核心的 miniPC 产品，具备四核 A55@1.8GHz, G52 GPU、4K 编解码 VPU、1Tops AI NPU 的核心，4GB LPDDR4+32GB eMMC, 100% 国产化物料核心板。通过兼容树莓派接口 40pin 插针引出，另外还有米尔自定义 40pin 插座扩展。

● 产品参数



MYD-LR3568 微型工控机正面



MYD-LR3568 微型工控机背面

	功能	参数
系统	POWER	12VDC 5.08 凤凰端子
	Debug	1 路 USB Type-C, 内置 USB 转 UART DEBUG
	KEY	RST、UPLOAD、PWR、+、-
	SSD	M.2 2280 NVME SSD 固态硬盘槽位
	SD	1 路 Micro SD 卡槽
通讯接口	Ethernet	2 路 10/100/1000M 以太网 RJ45 接口
	WIFI/BT	双频 WIFI 模块, 支持 802.11a/b/g/n/AC+BT 5.2
	4G/5G	板载 miniPCIE 插槽, SIM 卡插槽, 可支持 4G/5G 模块
	USB	2 路 USB3.0, 在 1x2 Type-A 接口 3 路 USB2.0, Type-A 接口
	UART	2 路 RS485 接口, 1 路 RS232 接口
	CAN	2 路 CAN 接口
多媒体接口	DISPLAY	1 路 HDMI 接口, HDMI A-type 插座 1 路 DP 接口, miniDP 插座
	AUDIO	1 路音频接口, 3.5mm 耳麦插座

● 应用场景



工控机



多屏高清播放器



电力测控终端



数据采集

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

产品型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	工作温度	尺寸	软件
MYD-LR3568J-16E2D-180-I-GK-B	瑞芯微RK3568J	4×Cortex-A55@1.8GHz 1Tops NPU	2GB LPDDR4	16GB eMMC	-40°C~+85°C	160×94×44mm	Linux Ubuntu Android
MYD-LR3568J-32E4D-180-I-GK-B			4GB LPDDR4	32GB eMMC			

Rockchip | MYD-LR3576-B边缘计算盒



扫一扫了解更多参数

产品介绍

MYD-LR3576-B 边缘计算盒是在 MYD-LR3576 开发板基础上衍生的产品，为客户提供一种适应性广泛的、算法丰富、边缘计算盒子产品。

采用 12V/3A 直流供电，搭载了两路千兆以太网接口、板载 WIFI+BT 模块、HDMI+miniDP+MI-PI-DSI 三种显示接口、1 路 3.5mm 音频接口、2 路 USB3.0 接口、1 路 Micro SD 接口、3 路 MIPI-CSI 接口、1 路兼容树莓派 40pin 扩展接口、1 路米尔自定义 40pin 扩展接口。



MYD-LR3576-B 边缘计算盒正面



MYD-LR3576-B 边缘计算盒背面

应用场景



边缘计算机



电力智能设备



工业控制



综合网关

产品选型 (其他配置可批量定制)

产品型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	工作温度	尺寸	软件
MYD-LR3576-64E8D-220-C-B	RK3576	4×Cortex-A72@2.2GHz+ 4×Cortex-A53@1.8GHz+ Cortex-M0@400MHz, 6TOPS NPU	8GB LPDDR4X	64GB eMMC	0°C~+70°C	165×93×34.5mm	Debian Linux

产品参数

	功能	参数
系统	POWER	12VDC 5.08 凤凰端子
	Debug	1 路 USB2.0 Type-C 内部 USB 转 TTL DEBUG
	KEY	1 路 RST 复位按键、1 路 USER 用户按键
	SSD	1 路 M.2 2280 NVME SSD 固态硬盘槽位
	SD	1 路 Micro SD 卡槽
通讯接口	Ethernet	2 路 10/100/1000M 以太网 RJ45 接口
	WIFI/BT 板载	WIFI 模块,支持 802.11a/b/g/n/AC+BT 5.2
	4G/5G	板载 miniPCIE 插槽,SIM 卡插槽,可支持 4G/5G 模块
	USB	2 路 USB3.0, 在 1x2 Type-A 接口
		3 路 USB2.0, Type-A 接口
	UART	2 路 RS485 接口
1 路 RS232 接口		
CAN	2 路 CAN 接口	
多媒体接口	DISPLAY	1 路 HDMI 接口 ,HDMI A-type 插座
		1 路 DP 接口, MiniDP 插座
	AUDIO	1 路音频接口, 3.5mm 耳麦插座



扫一扫了解更多参数

● 产品介绍

MYD-JD9340 工控机是以芯驰 D9340 处理器为核心的边缘计算网关产品，具备四核 A55@1.6GHz, 32GFLOPS GPU、1080p 编解码 VPU、硬件存储 ECC、ASIL B 功能安全, 2GB LPDDR4+16GB eMMC, 100% 国产化物料核心板。具备 HDMI+1* 双 LVDS+1* 单 LVDS 三路显示接口, 支持双屏异显, 支持1路 MIPI-CSI 摄像接口, 3.5mm 音频插座, 支持双千兆网口、WIFI+BT、3*USB 扩展、2*RS232、2*RS485、2*CANFD、2*DI、2*DO 等。



MYD-JD9340 工控机正面



MYD-JD9340 工控机背面

● 应用场景



边缘计算机



电力智能设备



大算力控制器



综合网关

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

产品型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	工作温度	尺寸	软件
MYD-JD9340-16E2D-160-I-B4G	芯驰D9 (D9340)	4×Cortex-A55@1.6GHz +2×Cortex-R5@800MHz	2GB LPDDR4	16GB eMMC	-40°C~+85°C	160×154×40mm	Android Linux Ubuntu

● 产品参数

	功能	参数	
系统	POWER	12V/2A, 3PIN 凤凰接线端子	
	KEY	1 路复位按键、1 路用户按键	
	BOOT SET	1 路 4bit 拨码开关	
	SD	1 路 Micro SD 卡槽	
	LED		1 路 5G/4G 状态指示灯, 1 路系统运行指示灯
			1 路电源指示, 1 路用户自定义灯
DEBUG		1 路 AP1 调试串口,	
		1 路 R5 调试串口, 1 路 JTAG 调试接口	
通讯接口	WIFI/BT	板载 WIFI/BT 模块	
	5G/4G	1 路 M.2 B 型插座 5G/4G 模块接口 / 1 路 SIM 卡座	
	Ethernet	2 路 10/100/1000M 以太网接口, RJ45 接口, 支持 TSN	
	USB		2 路 USB 3.0 HOST 接口, 采用 Type-A 接口
			1 路 USB 2.0 DRD 接口, 采用 Type-C 接口
	UART		2 路带隔离的 RS485 接口, 通过凤凰端子引出
			2 路 RS232 接口, 通过凤凰端子引出
	CAN	2 路带隔离的 CAN 接口, 通过凤凰端子引出	
DI/DO	各 2 路带隔离的 DI、DO 接口, 通过凤凰端子引出		
多媒体接口	DISPLAY	1 路双通道 LVDS 显示接口	
		1 路 HDMI 接口, 通过 MIPI-DSI 转	
		1 路单通道 LVDS 显示接口, 通过 MIPI-DSI 转	
	CAMERA	1 路 MIPI CSI 摄像头接口	
AUDIO	1 路音频输入输出接口		
扩展接口	Expansion IO	1 路扩展接口, 通过排针引出	



扫一扫了解更多参数

MY-EVC700S-V2嵌入式控制单元

● 产品介绍

米尔电子充电桩计费控制单元，通过软硬件接口连接相应输入 / 输出组件，完成人机显示、计量计费、支付、数据加解密、控制充电设备启停、与运营平台通信等功能。



正面

背面

● 应用场景



充电桩计费控制



医疗器械



工业领域



电力网关



数据采集

● 产品选型 (其他配置可批量定制)

产品型号	主芯片	内核+主频	RAM	ROM	工作和存储环境	尺寸	软件
MY-EVC700S-V2	T113-i	2×Cortex-A7@1.1G	512MB DDR3	4GB eMMC	湿度: 5% ~ 95% 无凝露 工作温度: -20°C ~ 60°C 存储温度: -40°C ~ 85°C	194×148×32.5mm	Linux

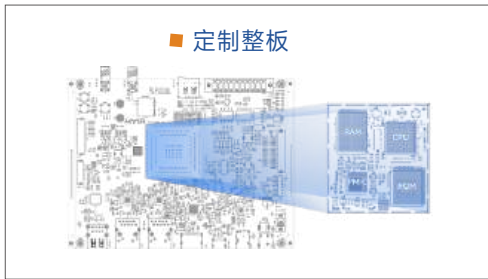
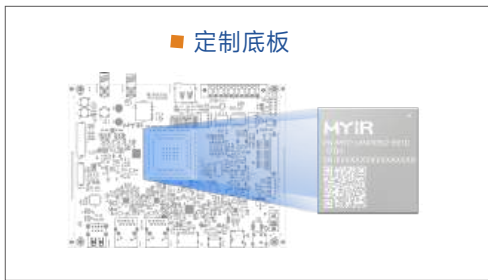
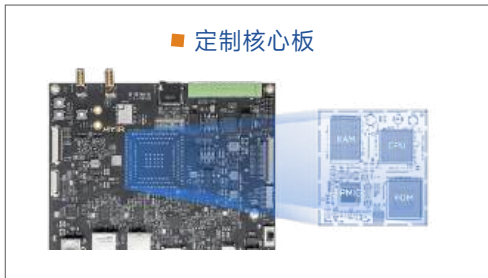
● 产品参数

功能	指标要求
CPU 主频	T113-i@1.1GHz
内存	512MB, DDR3
eMMC	4GB
外扩存储	标准 SD 卡, 支持最高 32G; SD 卡安装方式: 标准 SD 卡, 外插式安装
移动通信	配置同时支持中国移动、中国联通、中国电信的 4G 全网通通信模块 1 个标准 SIM 卡插槽, 无线拨号程序具备断线自动重连功能
蓝牙、WIFI	蓝牙、WIFI 集成的模块, 蓝牙 5.0
HDMI	带触摸的 LVDS 转 HDMI 模块
触摸彩屏	LVDS 接口 (20 线), 4 线电阻触摸屏接口, 4 线背光电源接口
掉电检测	1 路 GPIO, 备输入工作电源掉电不间断持续供电 10 s 以上功能
UART	3 路 RS232: RS232-1: Console 口; RS232-2: 读卡器通信; RS232-3: 备用; 2 路 RS485: RS485-1: 电表通信; RS485-2: 备用;
USB	2 路 USB: USB-01: USB HUB 引出 USB 接口, 于插入 U 盘; USB-02: 用于 4G 模块
CAN BUS	2 路 CAN: CAN-01: CAN2.0 B, 125/250kbps, 与充电控制器通信; CAN-02: 备用
网络	1 路 10/100M: RJ45-01: 用于连接上级系统
声音	(1) 蜂鸣器; (2) 内置功放, ≥0.5W, 标准 3.5 音频插口, 立体声
时钟	RTC 时钟, 具有掉电保持至少 1 年功能

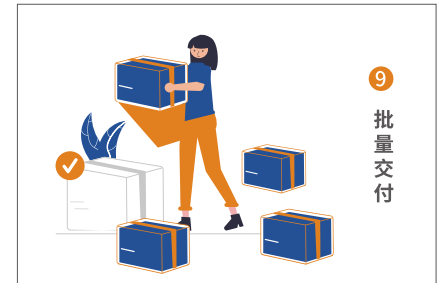
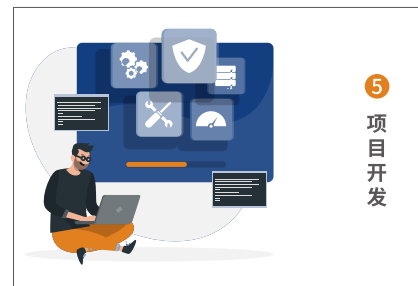
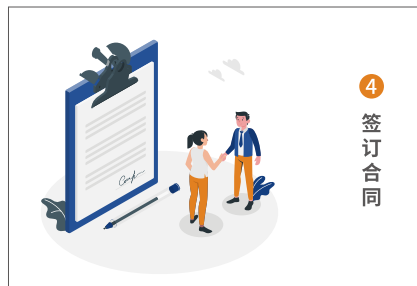
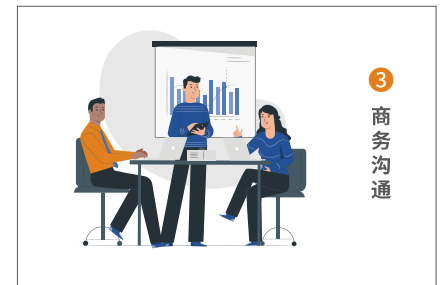
ODM服务

米尔基于多年的行业深耕,在基于 ARM/FPGA 内核处理器的嵌入式软、硬件开发上,积累了丰富的产品技术和项目开发经验,米尔也针对客户个性化的需求,提供专业,高效的定制服务。

定制方案



定制服务流程



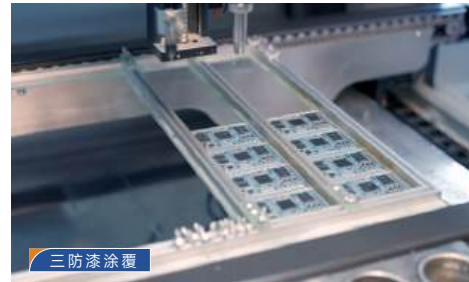
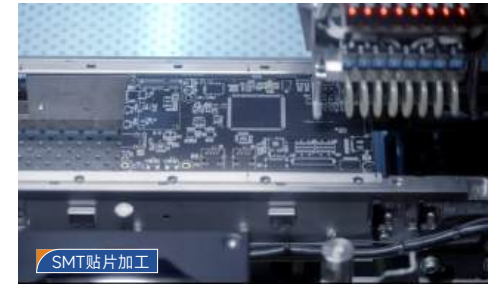
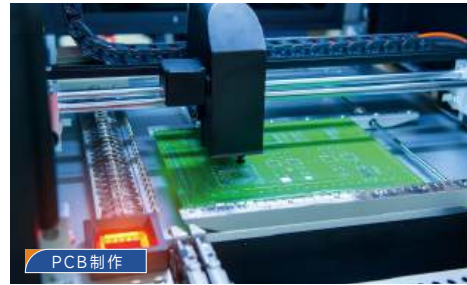
OEM服务



扫一扫了解更多

米尔智慧化 SMT 工厂致力于为客户提供从 PCB 制作、元器件采购、贴片加工到组装测试的一站式 PCBA 生产服务。米尔工厂位于深圳市龙华区，以先进的生产设备和管理系统、严格的品质管控流程、完善的供应链体系、强力的工程支撑等优势，帮助客户提升生产效率、缩短产品交期、保证生产品质，服务于国内外众多工业控制、电力通讯、新能源、汽车电子、医疗电子、智能家居及安防等各行业客户。

一站式 PCBA 服务范围



OEM 服务覆盖众多行业



工业控制



电力通讯



新能源



汽车电子



医疗仪器



智能安防



工程机械



轨道交通



工业网关



北京分公司
电话: 010-84675491 | 13316862895
地址: 北京市大兴区荣华中路8号院力宝广场10号楼901室



上海分公司
电话: 021-62087019 | 15338794610
地址: 上海市浦东新区金吉路778号浦发江程广场1号楼805室



深圳总部
电话: 0755-25622735 | 17324413392
地址: 深圳市龙岗区坂田街道发达路云里智能园2栋604室



武汉分公司&研发中心
电话: 027-59621648
地址: 武汉东湖新技术开发区关南园一路20号当代科技园4号楼1601号



深圳生产基地
电话: 0755-21015844
地址: 深圳市龙华区观澜街道大富工业区圣建利工业园C栋厂房2楼

MYiR 米尔电子
Make Your Idea Real
深圳市米尔电子有限公司

技术支持电话: 027-59621648 / 0755-22316235

业务咨询邮箱: sales.cn@myir.cn 技术支持邮箱: support.cn@myir.cn



天猫旗舰店



微信公众号